

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-026733

(43)Date of publication of application : 29.01.1999

(51)Int.Cl.

H01L 27/12
G02F 1/136
H01L 29/786
H01L 21/336

(21)Application number : 09-193080

(71)Applicant : SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing : 03.07.1997

(72)Inventor : SHIMODA TATSUYA
INOUE SATOSHI
MIYAZAWA WAKAO

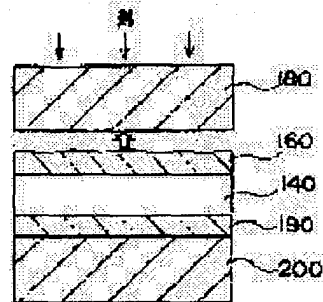
(54) TRANSFER METHOD OF THIN FILM DEVICE, THIN FILM DEVICE, THIN FILM INTEGRATED CIRCUIT DEVICE, ACTIVE MATRIX SUBSTRATE, LIQUID CRYSTAL DISPLAY AND ELECTRONIC EQUIPMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable independently and freely selecting a substrate to be used at the time of manufacturing a thin film device and a substrate to be used at the time of, e.g. real use of a product, and enable transferring the thin film device on the substrate to be used at the time of real use while the lamination order at the time of manufacturing the thin film device is maintained.

SOLUTION: A first isolation layer like amorphous silicon is arranged on a substrate of high reliability into which a laser light can be transmitted, and a thin film device 140 like a TFT is formed on the substrate. A second isolation layer 160 like a hot-melt adhesive layer is formed on the thin film device 140, and a primary transferring member 180 is formed on the second isolation layer 160. Bonding force of the primary isolation layer is weakened, e.g. by irradiating the first isolation layer with a light, and the substrate is eliminated, so that a thin film device 140 is primarily transferred on the primary transferring member.

A secondary transferring member 200 is bonded to the lower surface of the exposed thin film device via an adhesive layer 190. Bonding force is weakened, e.g. by hot-melting the second isolation layer 160, and the primary transferring member is eliminated. Thereby the thin film device 140 is secondarily transferred on the secondary transferring member.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision
of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-26733

(43) 公開日 平成11年(1999) 1月29日

(51) IntCl.⁶ 識別記号

H 0 1 L 27/12

G 0 2 F 1/136

H 0 1 L 29/786

21/336

5 0 0

F I

H 0 1 L 27/12

G 0 2 F 1/136

H 0 1 L 29/78

B

5 0 0

6 2 6 C

6 2 6 Z

6 2 7 D

審査請求 未請求 請求項の数24 F D (全 24 頁)

(21) 出願番号 特願平9-193080

(22) 出願日 平成9年(1997) 7月3日

(71) 出願人 000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(72) 発明者 下田 達也

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

(72) 発明者 井上 聡

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

(72) 発明者 宮沢 和加雄

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

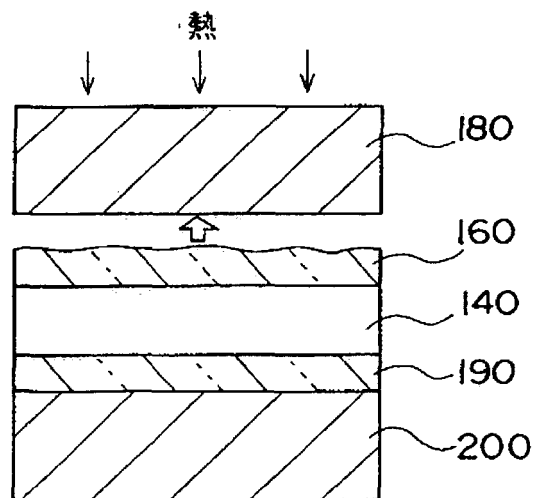
(74) 代理人 弁理士 井上 一 (外2名)

(54) 【発明の名称】 薄膜デバイスの転写方法、薄膜デバイス、薄膜集積回路装置、アクティブマトリクス基板、液晶表示装置および電子機器

(57) 【要約】

【課題】 薄膜デバイスの製造時に使用する基板と、例えば製品の実使用時に使用する基板とを、独立に自由に選択でき、しかも薄膜デバイスの製造時の積層順序を維持したまま、実使用時の基板に薄膜デバイスを転写することを可能とする新規な技術を提供すること

【解決手段】 信頼性が高く、かつレーザー光が透過可能な基板(100)上にアモルファスシリコンなどの第1分離層(120)を設けておき、その基板上にTFT等の薄膜デバイス(140)を形成する。さらに、薄膜デバイス(140)上に熱溶融性接着層などの第2分離層(160)を形成し、その上に一次転写体(180)を形成する。例えば光照射で第1分離層の結合力を弱めて基板を除去することで、薄膜デバイスが一次転写体に一次転写される。さらに、露出した薄膜デバイスの下面に接着層(190)を介して二次転写体(200)を接合する。そして、第2分離層を例えば熱溶融させて結合力を弱め、一次転写体を除去する。これにより、薄膜デバイスは二次転写体に二次転写される。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基板上に第 1 分離層を形成する第 1 工程と、
前記第 1 分離層上に薄膜デバイスを含む被転写層を形成する第 2 工程と、
前記被転写層上に第 2 分離層を形成する第 3 工程と、
前記第 2 分離層上に一次転写体を接合する第 4 工程と、
前記第 1 分離層を境にして、前記被転写層より前記基板を除去する第 5 工程と、
前記被転写層の下面に二次転写体を接合する第 6 工程と、
前記第 2 分離層を境にして、前記被転写層より前記一次転写体を除去する第 7 工程と、
を有し、前記薄膜デバイスを含む前記被転写層を二次転写体に転写することを特徴とする薄膜デバイスの転写方法。

【請求項 2】 請求項 1 において、
前記第 5 工程は、前記第 1 分離層に光を照射し、前記第 1 分離層の層内および／または界面において剥離を生じさせる工程を含むことを特徴とする薄膜デバイスの転写方法。

【請求項 3】 請求項 2 において、
前記基板は透光性の基板であり、
前記第 1 分離層への光照射は、前記透光性の基板を介して行われることを特徴とする薄膜デバイスの転写方法。

【請求項 4】 請求項 1 乃至 3 のいずれかにおいて、
前記第 2 分離層は、熱溶融性接着剤であり、
前記第 5 工程は、加熱によって前記熱溶融性接着剤を溶融させる工程を含むことを特徴とする薄膜デバイスの転写方法。

【請求項 5】 請求項 1 乃至 3 のいずれかにおいて、
前記第 7 工程は、前記第 2 分離層に光を照射し、前記第 2 分離層の層内および／または界面において剥離を生じさせる工程を含むことを特徴とする薄膜デバイスの転写方法。

【請求項 6】 請求項 5 において、
前記一次転写体は透光性であり、
前記第 2 分離層への光照射は、透光性の前記一次転写体を介して行われることを特徴とする薄膜デバイスの転写方法。

【請求項 7】 請求項 1 乃至 6 のいずれかにおいて、
前記第 2 工程は、前記薄膜デバイスの形成後に、該薄膜デバイスに導通する電極形成工程を含むことを特徴とする薄膜デバイスの転写方法。

【請求項 8】 請求項 1 乃至 7 のいずれかにおいて、
前記二次転写体は、透明基板であることを特徴とする薄膜デバイスの転写方法。

【請求項 9】 請求項 1 乃至 8 のいずれかにおいて、
前記二次転写体は、被転写層の形成の際の最高温度を T_{\max} としたとき、ガラス転移点 (T_g) または軟化点が

前記 T_{\max} 以下の材料で構成されていることを特徴とする薄膜デバイスの転写方法。

【請求項 10】 請求項 1 乃至 8 のいずれかにおいて、
前記二次転写体は、ガラス転移点 (T_g) または軟化点が、前記薄膜デバイスの形成プロセスの最高温度以下であることを特徴とする薄膜デバイスの転写方法。

【請求項 11】 請求項 1 乃至 10 のいずれかにおいて、
前記二次転写体は、合成樹脂またはガラス材で構成されていることを特徴とする薄膜デバイスの転写方法。

【請求項 12】 請求項 1 乃至 11 のいずれかにおいて、
前記基板は、耐熱性を有することを特徴とする薄膜デバイスの転写方法。

【請求項 13】 請求項 1 乃至 12 のいずれかにおいて、
前記基板は、被転写層の形成の際の最高温度を T_{\max} としたとき、歪み点が前記 T_{\max} 以上の材料で構成されていることを特徴とする薄膜デバイスの転写方法。

【請求項 14】 請求項 1 乃至 13 のいずれかにおいて、
前記薄膜デバイスは薄膜トランジスタ (TFT) を含むことを特徴とする薄膜デバイスの転写方法。

【請求項 15】 請求項 1 乃至 14 のいずれかにおいて、
請求項 1 に記載の転写方法を複数回実行して、前記基板よりも大きい前記二次転写体上に、複数の被転写層を転写することを特徴とする薄膜デバイスの転写方法。

【請求項 16】 請求項 1 乃至 14 のいずれかにおいて、
請求項 1 に記載の転写方法を複数回実行して、前記二次転写体上に、薄膜デバイスの設計ルールレベルが異なる複数の被転写層を転写することを特徴とする薄膜デバイスの転写方法。

【請求項 17】 請求項 1 乃至 16 のいずれかに記載の転写方法を用いて前記二次転写体に転写されてなる薄膜デバイス。

【請求項 18】 請求項 1 乃至 16 のいずれかに記載の転写方法を用いて前記二次転写体に転写された薄膜デバイスを含んで構成される薄膜集積回路装置。

【請求項 19】 マトリクス状に配置された薄膜トランジスタ (TFT) と、その薄膜トランジスタの一端に接続された画素電極とを含んで画素部が構成されるアクティブマトリクス基板であって、
請求項 1 乃至 16 のいずれかに記載の方法を用いて前記画素部の薄膜トランジスタを転写することにより製造されたアクティブマトリクス基板。

【請求項 20】 マトリクス状に配置された走査線と信号線とに接続される薄膜トランジスタ (TFT) と、その薄膜トランジスタの一端に接続された画素電極とを含

んで画素部が構成され、かつ、前記走査線および前記信号線に信号を供給するためのドライバ回路を内蔵するアクティブマトリクス基板であって、

請求項16に記載の方法を用いて形成された、第1の設計ルールレベルの前記画素部の薄膜トランジスタおよび第2の設計ルールレベルの前記ドライバ回路を構成する薄膜トランジスタを具備するアクティブマトリクス基板。

【請求項21】 請求項19または20に記載のアクティブマトリクス基板を用いて製造された液晶表示装置。

【請求項22】 請求項1乃至16のいずれかに記載の転写方法を用いて前記二次転写体に転写されてなる薄膜デバイスを有することを特徴とする電子機器。

【請求項23】 請求項22において、前記二次転写体が機器のケースであり、前記ケースの内面及び外面の少なくとも一方の面に前記薄膜デバイスが転写されていることを特徴とする電子機器。

【請求項24】 基板上に第1分離層を形成する第1工程と、

前記第1分離層上に薄膜デバイスを含む被転写層を形成する第2工程と、

前記第1分離層を境にして、前記被転写層より前記基板を除去する第3工程と、

前記被転写層の下面に転写体を接合する第4工程と、を有し、前記薄膜デバイスを含む前記被転写層を前記転写体に転写することを特徴とする薄膜デバイスの転写方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、薄膜デバイスの転写方法、薄膜デバイス、薄膜集積回路装置、アクティブマトリクス基板、液晶表示装置および電子機器に関する。

【0002】

【背景技術】例えば、薄膜トランジスタ(TFT)を用いた液晶ディスプレイを製造するに際しては、基板上に薄膜トランジスタをCVD等により形成する工程を経る。薄膜トランジスタを基板上に形成する工程は高温処理を伴うため、基板は耐熱性に優れる材質のもの、すなわち、軟化点および融点が高いものを使用する必要がある。そのため、現在では、1000℃程度の温度に耐える基板としては石英ガラスが使用され、500℃前後の温度に耐える基板としては耐熱ガラスが使用されている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】上述のように、薄膜デバイスを搭載する基板は、それらの薄膜デバイスを製造するための条件を満足するものでなければならない。つまり、使用する基板は、搭載されるデバイスの製造条件を必ず満たすように決定される。

【0004】しかし、TFT等の薄膜デバイスを搭載した基板が完成した後の段階のみに着目すると、上述の「基板」が必ずしも好ましくないこともある。

【0005】例えば、上述のように、高温処理を伴う製造プロセスを経る場合には、石英基板や耐熱ガラス基板等が用いられるが、これらは非常に高価であり、したがって製品価格の上昇を招く。

【0006】また、ガラス基板は重く、割れやすいという性質をもつ。パーソナルコンピュータや携帯電話機等の携帯用電子機器に使用される液晶ディスプレイでは、可能な限り安価で、軽くて、多少の変形にも耐え、かつ落としても壊れにくいのが望ましいが、現実には、ガラス基板は重く、変形に弱く、かつ落下による破壊の恐れがあるのが普通である。

【0007】つまり、製造条件からくる制約と製品に要求される好ましい特性との間に溝があり、これら双方の条件や特性を満足させることは極めて困難であった。

【0008】そこで本発明者等は、薄膜デバイスを含む被転写層を従来のプロセスにて基板上に形成した後に、この薄膜デバイスを含む被転写層を基板から離脱させて、転写体に転写させる技術を提案している(特願平8-225643号)。このために、基板と被転写層である薄膜デバイスとの間に、分離層を形成している。この分離層に光を照射することで、分離層の層内および/または界面を剥離させて、基板と被転写層との結合力を弱めることで、被転写層を基板から離脱させることを可能としている。この結果、被転写層は転写体に転写される。ここで、薄膜デバイスを形成するのに高温処理を伴う製造プロセスを経る場合には、石英基板や耐熱ガラス基板等が用いられる。しかし、転写体はこのような高温処理に晒されることがないので、転写体として求められる制約が大幅に緩和される利点がある。

【0009】ところで、薄膜デバイスを含む被転写層が、薄膜デバイスの製造に用いられた基板から離脱されて転写体に転写されると、基板に対する被転写層の積層関係と、転写体に対する被転写層との関係は逆になってしまう。すなわち、当初基板側と対面していた被転写層の一面は、転写体と対面しなくなる。このことを、被転写層が例えば第1、第2層の二層から構成された場合について説明すると、基板上に第1層、第2層の順で形成された被転写層は、転写体上に第2層、第1層の順で形成されることになる。

【0010】一般に、基板上に薄膜デバイスを形成する場合、この素子形成後に絶縁層を介して電極が形成される。従って、この電極は表層側に位置するので、その電極への配線あるいはコンタクトは容易である。ところが、この薄膜デバイス及び電極を含む被転写層を転写体に転写すると、電極は転写体に覆われてしまい、この電極へ配線あるいはコンタクトが困難となる。

【0011】本発明はこのような問題点に着目してなす

れたものであり、その目的の一つは、薄膜デバイスの製造時に使用する基板と、例えば製品の実使用時に使用する基板（製品の用途からみて好ましい性質をもった基板）とを、独立に自由に選択することを可能とし、しかも、製造時に使用した基板に対する薄膜デバイスの積層関係をそのまま維持して、その薄膜デバイスを実使用時に使用する基板に転写することができる新規な技術を提供することにある。

【0012】

【課題を解決するための手段】上述した課題を解決する本発明は、以下のような構成をしている。

【0013】請求項1に記載の発明に係る薄膜デバイスの転写方法は、基板上に第1分離層を形成する第1工程と、前記第1分離層上に薄膜デバイスを含む被転写層を形成する第2工程と、前記被転写層上に第2分離層を形成する第3工程と、前記第2分離層上に一次転写体を接合する第4工程と、前記第1分離層を境にして、前記被転写層より前記基板を除去する第5工程と、前記被転写層の下面に二次転写体を接合する第6工程と、前記第2分離層を境にして、前記被転写層より前記一次転写体を除去する第7工程と、を有し、前記薄膜デバイスを含む前記被転写層を二次転写体に転写することを特徴とする。

【0014】デバイス製造における信頼性が高い例えば石英基板などの基板上に、後に分離可能な第1分離層を設けておき、その基板上にTFT等の薄膜デバイスを含む被転写層を形成する。次に、この被転写層上に、後に分離可能な第2分離層を形成し、さらに第2分離層上に一次転写体を接合する。その後第1分離層を境にして、薄膜デバイス製造時に使用した基板を、被転写層より

分離させる。このままでは、当初の基板に対する被転写層の積層関係と、一次転写体に対する被転写層の積層関係とは逆転している。

【0015】そこで、好ましくは被転写層の下面より第1分離層を除去した後に、その下面に二次転写体を接合する。そして、第2分離層を境にして、一次転写体を被転写層より分離させる。こうすると、被転写層に対して、当初の基板が位置していた場所に二次転写体が存在することになり、当初の基板に対する被転写層の積層関係と、二次転写体に対する被転写層の積層関係とが一致

する。

【0016】なお、被転写層の下層に二次転写体を接合する工程と、一次転写体を被転写層から分離させる工程とは、その順序を問わず、いずれが先でもかまわない。但し、一次転写体を分離させた後の被転写層のハンドリングに問題がある場合には、まず、被転写層を二次転写体に接合する工程を実施し、その後一次転写体を分離させる工程を実施するのが望ましい。この点から言えば、一次転写体の材質、特性として、少なくとも保型性を有するものであればよい。一次転写体は、薄膜デバイ

スの製造時には存在しないので、耐熱性、金属汚染などのプロセス上の制約を考慮する必要はない。

【0017】請求項2の発明は、請求項1において、前記第5工程は、前記第1分離層に光を照射し、前記第1分離層の層内および／または界面において剥離を生じさせる工程を含むことを特徴とする。

【0018】第1分離層に光を照射し、これによって、その第1分離層において剥離現象を生じせしめて、その第1分離層と基板との間の密着性を低下させる。これにより、基板に力を加えることで、その基板を被転写層から離脱させることができる。

【0019】請求項3の発明は、請求項2において、前記基板は透光性の基板であり、前記第1分離層への光照射は、前記透光性の基板を介して行われることを特徴とする。

【0020】こうすると、薄膜デバイスに直接光を照射することなく、第1分離層にて剥離を生じさせることができ、薄膜デバイスの特性を劣化することが低減する。

【0021】請求項4の発明は、請求項1乃至3のいずれかにおいて、前記第2分離層は、熱溶融性接着剤であり、前記第5工程は、加熱によって前記熱溶融性接着剤を溶融させる工程を含むことを特徴とする。

【0022】第2分離層として接着剤を用いれば、その後工程である一次転写体の接合のための接着剤として兼用でき、しかも、一次転写体の接合後に加熱することで、一次転写体の分離も容易にできる。

【0023】また、薄膜デバイスを含む被転写層の表面に多少の段差が生じていたとしても、熱溶融性接着剤を平坦化層として兼用することで、その段差を平坦化することができ、一次転写体との接合が容易となる。

【0024】請求項5の発明は、請求項1乃至3のいずれかにおいて、前記第7工程は、前記第2分離層に光を照射し、前記第2分離層の層内および／または界面において剥離を生じさせる工程を含むことを特徴とする。

【0025】第2分離層に光を照射し、これによって、その第2分離層において剥離現象を生じせしめて、その第2分離層と一次転写体との間の密着性を低下させる。これにより、一次転写体に力を加えることで、その一次転写体を被転写層から離脱させることができる。

【0026】請求項6の発明は、請求項5において、前記一次転写体は透光性であり、前記第2分離層への光照射は、透光性の前記一次転写体を介して行われることを特徴とする。

【0027】こうすると、薄膜デバイスに直接光を照射することなく、第2分離層にて剥離を生じさせることができ、薄膜デバイスの特性を劣化することが低減する。

【0028】請求項7の発明は、請求項1乃至6のいずれかにおいて、前記第2工程は、前記薄膜デバイスの形成後に、該薄膜デバイスに導通する電極形成工程を含むことを特徴とする。

【0029】この場合、二次転写体、薄膜デバイス、電極の順に積層されることになり、二次転写体に被転写層を転写した後も、電極への配線またはコンタクトが容易となる。

【0030】ここで、被転写層に付着している第2分離層を除去する工程を、さらに有することが好ましい。

【0031】不要な第2分離層を完全に除去するものである。

【0032】ここで、二次転写体としての好まし材質、特性などについて言及すれば、一次転写体と同様に、薄膜デバイスの製造時には存在しないため、耐熱性、金属汚染などのプロセス上の制約は考慮することなく選択できる。

【0033】この二次転写体は、請求項8に示すように、透明基板とすることもできる。

【0034】この透明基板として、例えば、ソーダガラス基板等の安価な基板や、可撓性を有する透明なプラスチックフィルム等を挙げることができる。透明基板とすれば、例えば薄膜デバイスが形成された液晶パネル用の基板として利用できる。

【0035】また、二次転写体は、請求項9に示すように、被転写層の形成の際の最高温度を T_{\max} としたとき、ガラス転移点(T_g)または軟化点が前記 T_{\max} 以下の材料で構成されていることが好ましい。

【0036】デバイス製造時の最高温度に耐えられず、従来は使用できなかった安価なガラス基板等を、自由に使用できるようになるからである。一次転写体も同様に、薄膜デバイスのプロセス時の温度に対する耐熱性は必要とされない。

【0037】請求項10に示すように、二次転写体は、ガラス転移点(T_g)または軟化点が、薄膜デバイスの形成プロセスの最高温度以下であってもよく、なぜなら、薄膜デバイスの形成時に転写体はその最高温度に晒されることがないからである。

【0038】この二次転写体は、請求項11に示すように、合成樹脂またはガラス材で構成することができる。

【0039】例えば、プラスチックフィルム等の撓み性(可撓性)を有する合成樹脂板を二次転写体とし、それに薄膜デバイスを転写すれば、剛性の高いガラス基板では得られないような優れた特性が実現可能である。本発明を液晶表示装置に適用すれば、しなやかで、軽くかつ落下にも強いディスプレイ装置が実現する。

【0040】また、例えば、ソーダガラス基板等の安価な基板も二次転写体として使用できる。ソーダガラス基板は低価格であり、経済的に有利な基板である。ソーダガラス基板は、TFT製造時の熱処理によりアルカリ成分が溶出するといった問題があり、従来は、アクティブマトリクス型の液晶表示装置への適用が困難であった。しかし、本発明によれば、すでに完成した薄膜デバイスを転写するため、上述の熱処理に伴う問題は解消され

る。よってアクティブマトリクス型の液晶表示装置の分野において、ソーダガラス基板等の従来問題があった基板も使用可能となる。

【0041】次に、被転写層が形成される基板の材質、特性などについて言及すれば、この基板は、請求項12に示すように、耐熱性を有することが好ましい。

【0042】薄膜デバイスの製造時に所望の高温処理が可能となり、信頼性が高く高性能の薄膜デバイスを製造することができるからである。

【0043】また、前記基板は、310nmの光を10%以上透過することが好ましい。このとき、第1分離層への光照射工程では、310nmの波長を含む光を照射する。

【0044】第1分離層において剥離を生じさせるに足る光エネルギーを、基板を介して効率よく行うものである。

【0045】前記基板は、請求項13に示すように、被転写層の形成の際の最高温度を T_{\max} としたとき、歪み点が前記 T_{\max} 以上の材料で構成されていることが好ましい。

【0046】薄膜デバイスの製造時に所望の高温処理が可能となり、信頼性が高く高性能の薄膜デバイスを製造することができるからである。

【0047】次に、光照射により剥離を生ずる第1および/または第2分離層の好ましい材質、特性などについて説明すると、この第1および/または第2分離層は、アモルファスシリコンで構成されていることが好ましい。

【0048】アモルファスシリコンは光を吸収し、また、その製造も容易であり、実用性が高い。

【0049】さらには、前記アモルファスシリコンは、水素(H)を2原子%以上含有することが好ましい。

【0050】水素を含むアモルファスシリコンを用いた場合、光の照射に伴い水素が放出され、これによって分離層内に内圧が生じて、分離層における剥離を促す作用がある。

【0051】あるいは、前記アモルファスシリコンは、水素(H)を10原子%以上含有することができる。

【0052】水素の含有率が増えることにより、分離層における剥離を促す作用がより顕著になる。

【0053】光照射により剥離を生ずる第1および/または第2分離層の他の材質として、窒化シリコンを挙げることができる。

【0054】光照射により剥離を生ずる第1および/または第2分離層のさらに他の材質として、水素含有合金を挙げることができる。

【0055】この分離層として水素含有合金を用いると、光の照射に伴い水素が放出され、これによって分離層における剥離が促進される。

【0056】光照射により剥離を生ずる第1および/ま

たは第2分離層のさらに他の材質として、窒素含有金属合金を挙げることができる。

【0057】この分離層として窒素含有合金を用いると、光の照射に伴い窒素が放出され、これによって分離層における剥離が促進される。

【0058】この分離層は、多層膜とすることもできる。

【0059】単層膜に限定されないことを明らかとしたものである。

【0060】この多層膜は、アモルファスシリコン膜と
その上に形成された金属膜とから構成することができ
る。

【0061】光照射により剥離を生ずる第1および/または第2分離層のさらに他の材質として、セラミックス、金属、有機高分子材料の少なくとも一種から構成することができる。

【0062】光照射により剥離を生ずる第1および/または第2分離層として実際に使用可能なものをまとめて例示したものである。金属としては、例えば、水素含有合金や窒素含有合金も使用可能である。この場合、アモルファスシリコンの場合と同様に、光の照射に伴う水素ガスや窒素ガスの放出によって、分離層における剥離が促進される。

【0063】次に、光照射工程にて用いる光について説明すると、レーザー光を用いることが好ましい。

【0064】レーザー光はコヒーレント光であり、第1および/または第2分離層内において剥離を生じさせるのに適する。

【0065】このレーザー光は、その波長を、100nm～350nmとすることができる。

【0066】短波長で光エネルギーのレーザー光を用いることにより、第1および/または第2分離層における剥離を効果的に行うことができる。

【0067】上述の条件を満たすレーザーとしては、例えば、エキシマレーザーがある。エキシマレーザーは、短波長紫外域の高エネルギーのレーザー光出力が可能なガスレーザーであり、レーザー媒質として希ガス(Ar, Kr, Xe)とハロゲンガス(F₂, HCl)とを組み合わせたものを用いることにより、代表的な4種類の波長のレーザー光を出力することができる(XeF=351nm, XeCl=308nm, KrF=248nm, ArF=193nm)。

【0068】エキシマレーザー光の照射により、第1および/または第2分離層において、熱影響のない分子結合の直接の切断やガスの蒸発等の作用を生じせしめることができる。

【0069】レーザー光の波長としては、350nm～1200nmを採用することもできる。

【0070】第1および/または第2分離層において、例えばガス放出、気化、昇華等の相変化を起こさせて分

離特性を与える場合には、波長が350nm～1200nm程度のレーザー光も使用可能である。

【0071】次に、薄膜デバイスについて説明すると、請求項14に示すように、前記薄膜デバイスを薄膜トランジスタ(TFT)とすることができる。

【0072】高性能なTFTを、所望の二次転写体上に自由に転写(形成)できる。よって、種々の電子回路をその二次転写体上に搭載することも可能となる。

【0073】請求項15に記載の発明は、請求項1乃至14のいずれかにおいて、請求項1に記載の転写方法を複数回実行して、前記基板よりも大きい前記二次転写体上に、複数の被転写層を転写することを特徴とする。

【0074】信頼性の高い基板を繰り返し使用し、あるいは複数の基板を使用して薄膜パターンの転写を複数回実行することにより、信頼性の高い薄膜デバイスを搭載した大規模な回路基板を作成できる。

【0075】請求項16に記載の発明は、請求項1乃至14のいずれかにおいて、請求項1に記載の転写方法を複数回実行して、前記二次転写体上に、薄膜デバイスの設計ルールのレベルが異なる複数の被転写層を転写することを特徴とする。

【0076】一つの基板上に、例えば、種類の異なる複数の回路(機能ブロック等も含む)を搭載する場合、それぞれの回路に要求される特性に応じて、各回路毎に使用する素子や配線のサイズ(設計ルール、すなわちデザインルールと呼ばれるもの)が異なる場合がある。このような場合にも、本発明の転写方法を用いて、各回路毎に転写を実行していけば、設計ルールレベルの異なる複数の回路を一つの二次転写体上に実現できる。

【0077】請求項17に記載の発明は、請求項1乃至16のいずれかに記載の転写方法を用いて前記二次転写体に転写されてなる薄膜デバイスである。

【0078】本発明の薄膜デバイスの転写技術(薄膜構造の転写技術)を用いて、任意の基板(二次転写体)上に形成される薄膜デバイスである。

【0079】請求項18に記載の発明は、請求項1乃至16のいずれかに記載の転写方法を用いて前記二次転写体に転写された薄膜デバイスを含んで構成される薄膜集積回路装置である。

【0080】例えば、合成樹脂基板上に、薄膜トランジスタ(TFT)を用いて構成されたシングルチップマイクロコンピュータ等を搭載することも可能である。

【0081】請求項19に記載の発明は、マトリクス状に配置された薄膜トランジスタ(TFT)と、その薄膜トランジスタの一端に接続された画素電極とを含んで画素部が構成されるアクティブマトリクス基板であって、請求項1乃至16のいずれかに記載の方法を用いて前記画素部の薄膜トランジスタを転写することにより製造されたアクティブマトリクス基板である。

【0082】本発明の薄膜デバイスの転写技術(薄膜構

造の転写技術)を用いて、所望の基板(二次転写体)上に画素部を形成してなるアクティブマトリクス基板である。製造条件からくる制約を排して自由に基板(二次転写体)を選択できるため、従来になく新規なアクティブマトリクス基板を実現することも可能である。

【0083】請求項20に記載の発明は、マトリクス状に配置された走査線と信号線とに接続される薄膜トランジスタ(TFT)と、その薄膜トランジスタの一端に接続された画素電極とを含んで画素部が構成され、かつ、前記走査線および前記信号線に信号を供給するためのドライバ回路を内蔵するアクティブマトリクス基板であって、請求項16に記載の方法を用いて形成された、第1の設計ルールレベルの前記画素部の薄膜トランジスタおよび第2の設計ルールレベルの前記ドライバ回路を構成する薄膜トランジスタを具備するアクティブマトリクス基板である。

【0084】アクティブマトリクス基板上に、画素部のみならずドライバ回路も搭載し、しかも、ドライバ回路の設計ルールレベルと画素部の設計ルールレベルとが異なるアクティブマトリクス基板である。例えば、ドライバ回路の薄膜パターンを、シリコンTFTの製造装置を利用して形成すれば、集積度を向上させることが可能である。

【0085】請求項21に記載の発明は、請求項19又は20に記載のアクティブマトリクス基板を用いて製造された液晶表示装置である。

【0086】例えば、プラスチック基板を用いた、しなやかに曲がる性質をもった液晶表示装置も実現可能である。

【0087】請求項22に記載の発明は、請求項1乃至16のいずれかに記載の転写方法を用いて前記二次転写体に転写されてなる薄膜デバイスを有することを特徴とする電子機器である。この場合、請求項23に示すように、前記二次転写体として機器のケースを用い、前記ケースの内面及び外面の少なくとも一方の面に前記薄膜デバイスが転写される構造としても良い。

【0088】請求項24の発明に係る薄膜デバイスの転写方法は、基板上に分離層を形成する第1工程と、前記分離層上に薄膜デバイスを含む被転写層を形成する第2工程と、前記分離層を境にして、前記被転写層より前記基板を除去する第3工程と、前記被転写層の下面に転写体を接合する第4工程と、を有し、前記薄膜デバイスを含む前記被転写層を前記転写体に転写することを特徴とする。

【0089】請求項24の発明では、請求項1の発明のような第1、第2分離層および一次、二次転写体を用いず、分離層および転写体を用いて被転写層の転写を可能としている。この方法は被転写層自体に保形性があれば可能である。なぜなら、請求項1の発明では、基板除去後であって二次転写体への転写前に、一次転写体にて被

転写層を支持する必要があったが、被転写層自体に保形性があれば、一次転写層にて被転写層を支持する必要はないからである。このとき、被転写層は薄膜デバイス層のみでなく、補強層を有することができる。

【0090】

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。

【0091】(第1の実施の形態)図1～図9は本発明の第1の実施の形態(薄膜デバイスの転写方法)を説明するための図である。

【0092】[工程1]図1に示すように、基板100上に第1分離層(光吸収層)120を形成する。

【0093】以下、基板100および第1分離層120について説明する。

【0094】①基板100についての説明

基板100は、光が透過し得る透光性を有するものであるのが好ましい。

【0095】この場合、光の透過率は10%以上であるのが好ましく、50%以上であるのがより好ましい。この透過率が低過ぎると、光の減衰(ロス)が大きくなり、第1分離層120を剥離するのにより大きな光量が必要とする。

【0096】また、基板100は、信頼性の高い材料で構成されているのが好ましく、特に、耐熱性に優れた材料で構成されているのが好ましい。その理由は、例えば後述する被転写層140や中間層142を形成する際に、その種類や形成方法によってはプロセス温度が高くなる(例えば350～1000℃程度)ことがあるが、その場合でも、基板100が耐熱性に優れていれば、基板100上への被転写層140等の形成に際し、その温度条件等の成膜条件の設定の幅が広がるからである。

【0097】従って、基板100は、被転写層140の形成の際の最高温度を T_{max} としたとき、歪点が T_{max} 以上の材料で構成されているのが好ましい。具体的には、基板100の構成材料は、歪点が350℃以上のものが好ましく、500℃以上のものがより好ましい。このようなものとしては、例えば、石英ガラス、コーニング7059、日本電気ガラスOA-2等の耐熱性ガラスが挙げられる。

【0098】また、基板100の厚さは、特に限定されないが、通常は、0.1～5.0mm程度であるのが好ましく、0.5～1.5mm程度であるのがより好ましい。基板100の厚さが薄すぎると強度の低下を招き、厚すぎると、基板100の透過率が低い場合に、光の減衰を生じ易くなる。なお、基板100の光の透過率が高い場合には、その厚さは、前記上限値を超えるものであってもよい。なお、光を均一に照射できるように、基板100の厚さは、均一であるのが好ましい。

【0099】②第1分離層120の説明

第1分離層120は、照射される光を吸収し、その層内

10

20

30

40

50

および／または界面において剥離（以下、「層内剥離」、「界面剥離」と言う）を生じるような性質を有するものであり、好ましくは、光の照射により、第1分離層120を構成する物質の原子間または分子間の結合力が消失または減少すること、すなわち、アブレーションが生じて層内剥離および／または界面剥離に至るものがよい。

【0100】さらに、光の照射により、第1分離層120から気体が放出され、分離効果が発現される場合もある。すなわち、第1分離層120に含有されていた成分が気体となって放出される場合と、第1分離層120が光を吸収して一瞬気体になり、その蒸気が放出され、分離に寄与する場合とがある。このような第1分離層120の組成としては、例えば、次のA～Eに記載されるものが挙げられる。

【0101】A. アモルファスシリコン（a-Si）

このアモルファスシリコン中には、水素（H）が含有されていてもよい。この場合、Hの含有量は、2原子%以上程度であるのが好ましく、2～20原子%程度であるのがより好ましい。このように、水素（H）が所定量含有されていると、光の照射によって水素が放出され、第1分離層120に内圧が発生し、それが上下の薄膜を剥離する力となる。アモルファスシリコン中の水素（H）の含有量は、成膜条件、例えばCVDにおけるガス組成、ガス圧、ガス雰囲気、ガス流量、温度、基板温度、投入パワー等の条件を適宜設定することにより調整することができる。

【0102】B. 酸化ケイ素又はケイ酸化合物、酸化チタンまたはチタン酸化合物、酸化ジルコニウムまたはジルコン酸化合物、酸化ランタンまたはランタン酸化合物等の各種酸化物セラミックス、透電体（強誘電体）あるいは半導体

酸化ケイ素としては、 SiO_2 、 SiO_2 、 Si_3O_2 が挙げられ、ケイ酸化合物としては、例えば K_2SiO_3 、 Li_2SiO_3 、 CaSiO_3 、 ZrSiO_4 、 Na_2SiO_3 が挙げられる。

【0103】酸化チタンとしては、 TiO_2 、 Ti_2O_3 、 TiO_2 が挙げられ、チタン酸化合物としては、例えば、 BaTiO_4 、 BaTiO_3 、 $\text{Ba}_2\text{Ti}_9\text{O}_{20}$ 、 $\text{BaTi}_5\text{O}_{11}$ 、 CaTiO_3 、 SrTiO_3 、 PbTiO_3 、 MgTiO_3 、 ZrTiO_2 、 SnTiO_4 、 Al_2TiO_5 、 FeTiO_3 が挙げられる。

【0104】酸化ジルコニウムとしては、 ZrO_2 が挙げられ、ジルコン酸化合物としては、例えば BaZrO_3 、 ZrSiO_4 、 PbZrO_3 、 MgZrO_3 、 K_2ZrO_3 が挙げられる。

【0105】C. PZT、PLZT、PLLZT、PBZT等のセラミックスあるいは誘電体（強誘電体）

D. 窒化珪素、窒化アルミ、窒化チタン等の窒化物セラミックス

E. 有機高分子材料

有機高分子材料としては、 $-\text{CH}-$ 、 $-\text{CO}-$ （ケトン）、 $-\text{CONH}-$ （アミド）、 $-\text{NH}-$ （イミド）、 $-\text{COO}-$ （エステル）、 $-\text{N}=\text{N}-$ （アゾ）、 $-\text{CH}=\text{N}-$ （シフ）等の結合（光の照射によりこれらの結合が切断される）を有するもの、特に、これらの結合を多く有するものであればいかなるものでもよい。また、有機高分子材料は、構成式中に芳香族炭化水素（1または2以上のベンゼン環またはその縮合環）を有するものであってもよい。

【0106】このような有機高分子材料の具体例としては、ポリエチレン、ポリプロピレンのようなポリオレフィン、ポリイミド、ポリアミド、ポリエステル、ポリメチルメタクリレート（PMMA）、ポリフェニレンサルファイド（PPS）、ポリエーテルスルホン（PE S）、エポキシ樹脂等があげられる。

【0107】F. 金属

金属としては、例えば、Al、Li、Ti、Mn、In、Sn、Y、La、Ce、Nd、Pr、Gd、Smまたはこれらのうちの少なくとも1種を含む合金が挙げられる。

【0108】また、第1分離層120の厚さは、剥離目的や第1分離層120の組成、層構成、形成方法等の諸条件により異なるが、通常は、1nm～20μm程度であるのが好ましく、10nm～2μm程度であるのがより好ましく、40nm～1μm程度であるのがさらに好ましい。第1分離層120の膜厚が小さすぎると、成膜の均一性が損なわれ、剥離にムラが生じることがあり、また、膜厚が厚すぎると、第1分離層120の良好な剥離性を確保するために、光のパワー（光量）を大きくする必要があり、後に第1分離層120を除去する際に、その作業に時間がかかる。なお、第1分離層120の膜厚は、できるだけ均一であるのが好ましい。

【0109】第1分離層120の形成方法は、特に限定されず、膜組成や膜厚等の諸条件に応じて適宜選択される。たとえば、CVD（MOCVD、低圧CVD、ECR-CVDを含む）、蒸着、分子線蒸着（MB）、スパッタリング、イオンプレーティング、PVD等の各種気相成膜法、電気メッキ、浸漬メッキ（ディッピング）、無電解メッキ等の各種メッキ法、ラングミュア・プロジェット（LB）法、スピンコート、スプレーコート、ロールコート等の塗布法、各種印刷法、転写法、インクジェット法、粉末ジェット法等が挙げられ、これらのうちの2以上を組み合わせ形成することもできる。

【0110】例えば、第1分離層120の組成がアモルファスシリコン（a-Si）の場合には、CVD、特に低圧CVDやプラズマCVDにより成膜するのが好ましい。

【0111】また、第1分離層120をゾルゲル法によるセラミックスで構成する場合や、有機高分子材料で

構成する場合には、塗布法、特に、スピンコートにより成膜するのが好ましい。

【0112】[工程2]次に、図2に示すように、第1分離層120上に、被転写層（薄膜デバイス層）140を形成する。

【0113】この薄膜デバイス層140のK部分（図2において1点鎖鎖線で囲んで示される部分）の拡大断面図を、図2の右側に示す。図示されるように、薄膜デバイス層140は、例えば、 SiO_2 膜（中間層）142上に形成されたTFT（薄膜トランジスタ）を含んで構成され、このTFTは、ポリシリコン層にn型不純物を導入して形成されたソース、ドレイン層146と、チャネル層144と、ゲート絶縁膜148と、ゲート電極150と、層間絶縁膜154と、例えばアルミニウムからなる電極152とを具備する。

【0114】本実施の形態では、第1分離層120に接して設けられる中間層として SiO_2 膜を使用しているが、 Si_3N_4 などのその他の絶縁膜を使用することもできる。 SiO_2 膜（中間層）の厚みは、その形成目的や発揮し得る機能の程度に応じて適宜決定されるが、通常は、10nm～5 μm 程度であるのが好ましく、40nm～1 μm 程度であるのがより好ましい。中間層は、種々の目的で形成され、例えば、被転写層140を物理的または化学的に保護する保護層、絶縁層、導電層、レーザー光の遮光層、マイグレーション防止用のバリア層、反射層としての機能の内の少なくとも1つを発揮するものが挙げられる。

【0115】なお、場合によっては、 SiO_2 膜等の中間層を形成せず、第1分離層120上に直接被転写層（薄膜デバイス層）140を形成してもよい。

【0116】被転写層140（薄膜デバイス層）は、図2の右側に示されるようなTFT等の薄膜デバイスを含む層である。

【0117】薄膜デバイスとしては、TFTの他に、例えば、薄膜ダイオードや、シリコンのPIN接合からなる光電変換素子（光センサ、太陽電池）やシリコン抵抗素子、その他の薄膜半導体デバイス、電極（例：ITO、メサ膜のような透明電極）、スイッチング素子、メモリー、圧電素子等のアクチュエータ、マイクロミラー（ピエゾ薄膜セラミックス）、磁気記録薄膜ヘッド、コイル、インダクター、薄膜高透磁材料およびそれらを組み合わせたマイクロ磁気デバイス、フィルター、反射膜、ダイクロイックミラー等がある。上記の例示に限らず、本発明の趣旨に反しない種々の薄膜デバイスに適用できる。

【0118】このような薄膜デバイスは、その形成方法との関係で、通常、比較的高いプロセス温度を経て形成される。したがって、この場合、前述したように、基板100としては、そのプロセス温度に耐え得る信頼性の高いものが必要となる。

【0119】[工程3]次に、図3に示すように、薄膜デバイス層140上に、第2分離層として例えば熱溶融性接着層160を形成する。なお、第2分離層は、第1分離層と同様にアブレーション層で構成することもできる。

【0120】この熱溶融性接着層160として、薄膜デバイスへの不純物（ナトリウム、カリウムなど）汚染の虞が少ない、例えばブルーワックス（商品名）などのエレクトロンワックスを挙げることができる。

【0121】[工程4]さらに、図3に示すように、第2分離層である熱溶融性接着層160の上に、一次転写体180を接着する。この一次転写体180は、薄膜デバイス層140の製造後に接着されるものであるため、薄膜デバイス層140の製造時のプロセス温度などに対する制約はなく、常温時に保型性さえあればよい。本実施の形態ではガラス基板、合成樹脂など、比較的安価で保型性のある材料を用いている。なお、この一次転写体180としては、詳細を後述する二次転写体200と同一の材料を用いることができる。

【0122】[工程5]次に、図4に示すように、基板100の裏面側から光を照射する。

【0123】この光は、基板100を透過した後第1分離層120に照射される。これにより、第1分離層120に層内剥離および/または界面剥離が生じ、結合力が減少または消滅する。

【0124】第1分離層120の層内剥離および/または界面剥離が生じる原理は、第1分離層120の構成材料にアブレーションが生じること、また、第1分離層120に含まれているガスの放出、さらには照射直後に生じる溶融、蒸散等の相変化によるものであることが推定される。

【0125】ここで、アブレーションとは、照射光を吸収した固定材料（第1分離層120の構成材料）が光化学的または熱的に励起され、その表面や内部の原子または分子の結合が切断されて放出することをいい、主に、第1分離層120の構成材料の全部または一部が溶融、蒸散（気化）等の相変化を生じる現象として現れる。また、前記相変化によって微小な発砲状態となり、結合力が低下することもある。

【0126】第1分離層120が層内剥離を生じるか、界面剥離を生じるか、またはその両方であるかは、第1分離層120の組成や、その他種々の要因に左右され、その要因の1つとして、照射される光の種類、波長、強度、到達深さ等の条件が挙げられる。

【0127】照射する光としては、第1分離層120に層内剥離および/または界面剥離を起こさせるものであればいかなるものでもよく、例えば、X線、紫外線、可視光、赤外線（熱線）、レーザー光、ミリ波、マイクロ波、電子線、放射線（ α 線、 β 線、 γ 線）等が挙げられる。そのなかでも、第1分離層120の剥離（アブレーション）

ション)を生じさせ易いという点で、レーザ光が好ましい。

【0128】このレーザ光を発生させるレーザ装置としては、各種気体レーザ、固体レーザ(半導体レーザ)等が挙げられるが、エキシマレーザ、Nd-YAGレーザ、Arレーザ、CO₂レーザ、COレーザ、He-Neレーザ等が好適に用いられ、その中でもエキシマレーザが特に好ましい。

【0129】エキシマレーザは、短波長域で高エネルギーを出力するため、極めて短時間で第1分離層2にアブレーションを生じさせることができ、よって隣接する転写体180や基板100等に温度上昇をほとんど生じさせることなく、すなわち劣化、損傷を生じさせることなく、第1分離層120を剥離することができる。

【0130】また、第1分離層120にアブレーションを生じさせるに際して、光の波長依存性がある場合、照射されるレーザ光の波長は、100nm~350nm程度であるのが好ましい。

【0131】図10に、基板100の、光の波長に対する透過率の一例を示す。図示されるように、300nmの波長に対して透過率が急峻に増大する特性をもつ。このような場合には、300nm以上の波長の光(例えば、波長308nmのXe-Clエキシマレーザ光)を照射する。

【0132】また、第1分離層120に、例えばガス放出、気化、昇華等の相変化を起こさせて分離特性を与える場合、照射されるレーザ光の波長は、350から1200nm程度であるのが好ましい。

【0133】また、照射されるレーザ光のエネルギー密度、特に、エキシマレーザの場合のエネルギー密度は、10~5000mJ/cm²程度とするのが好ましく、100~500mJ/cm²程度とするのがより好ましい。また、照射時間は、1~1000nsec程度とするのが好ましく、10~100nsec程度とするのがより好ましい。エネルギー密度が低いまたは照射時間が短いと、十分なアブレーション等が生じず、また、エネルギー密度が高いまたは照射時間が長いと、第1分離層120を透過した照射光により被転写層140に悪影響を及ぼすおそれがある。

【0134】なお、第1分離層120を透過した照射光が被転写層140にまで達して悪影響を及ぼす場合の対策としては、例えば、第1分離層(レーザ吸収層)120上にタンタル(Ta)等の金属膜を形成する方法がある。これにより、第1分離層120を透過したレーザ光は、金属膜124の界面で完全に反射され、それより上の薄膜デバイスに悪影響を与えない。あるいは、第1分離層120上にシリコン系介在層例えばSiO₂を介して、シリコン系レーザ吸収層であるアモルファスシリコン層を形成することもできる。こうすると、第1分離層120を透過した光は、その上のアモルファス

シリコン層にて吸収される。ただしその透過光は、上層のアモルファスシリコン層にて再度アブレーションを生ずるほどの光エネルギーがない。また、金属とは異なり、アモルファスシリコン層上に薄膜デバイス層を形成できるので、既に確立された薄膜形成技術により品質の優れた薄膜デバイス層を形成できる。

【0135】レーザ光に代表される照射光は、その強度が均一となるように照射されるのが好ましい。照射光の照射方向は、第1分離層120に対し垂直な方向に限らず、第1分離層120に対し所定角度傾斜した方向であってもよい。

【0136】また、第1分離層120の面積が照射光の1回の照射面積より大きい場合には、第1分離層120の全領域に対し、複数回に分けて照射光を照射することもできる。また、同一箇所に2回以上照射してもよい。また、異なる種類、異なる波長(波長域)の照射光(レーザ光)を同一領域または異なる領域に2回以上照射してもよい。

【0137】次に、図5に示すように、基板100に力を加えて、この基板100を第1分離層120から離脱させる。図5では図示されないが、この離脱後、基板100上に第1分離層120が付着することもある。

【0138】[工程6]次に、図6に示すように、残存している第1分離層120を、例えば洗浄、エッチング、アッシング、研磨等の方法またはこれらを組み合わせた方法により除去する。これにより、被転写層(薄膜デバイス層)140が、一次転写体180に転写されたことになる。

【0139】なお、離脱した基板100にも第1分離層120の一部が付着している場合には同様に除去する。なお、基板100が石英ガラスのような高価な材料、希少な材料で構成されている場合等には、基板100は、好ましくは再利用(リサイクル)に供される。すなわち、再利用したい基板100に対し、本発明を適用することができ、有用性が高い。

【0140】[工程7]次に、図7に示すように、薄膜デバイス層140の下面(露出面)に、接着層190を介して、二次転写層200を接着する。

【0141】接着層190を構成する接着剤の好適な例としては、反応硬化型接着剤、熱硬化型接着剤、紫外線硬化型接着剤等の光硬化型接着剤、嫌気硬化型接着剤等の各種硬化型接着剤が挙げられる。接着剤の組成としては、例えば、エポキシ系、アクリレート系、シリコン系等、いかなるものでもよい。このような接着層190の形成は、例えば、塗布法によりなされる。

【0142】前記硬化型接着剤を用いる場合、例えば被転写層(薄膜デバイス層)140の下面に硬化型接着剤を塗布し、さらに二次転写体200を接合した後、硬化型接着剤の特性に応じた硬化方法により前記硬化型接着剤を硬化させて、被転写層(薄膜デバイス層)140と

二次転写体 200 とを接着し、固定する。

【0143】接着剤が光硬化型の場合、好ましくは光透過性の二次転写体 200 の外側から光を照射する。接着剤としては、薄膜デバイス層に影響を与えにくい紫外線硬化型などの光硬化型接着剤を用いれば、光透過性の一次転写体 180 側から、あるいは光透過性の一次、二次転写体 180、200 の両側から光照射しても良い。

【0144】なお、図示と異なり、二次転写体 200 側に接着層 190 を形成し、その上に被転写層（薄膜デバイス層）140 を接着してもよい。なお、例えば二次転写体 200 自体が接着機能を有する場合等には、接着層 190 の形成を省略してもよい。

【0145】二次転写体 200 としては、特に限定されないが、基板（板材）、特に透明基板が挙げられる。なお、このような基板は平板であっても、湾曲板であってもよい。また、二次転写体 200 は、前記基板 100 に比べ、耐熱性、耐食性等の特性が劣るものであってもよい。その理由は、本発明では、基板 100 側に被転写層（薄膜デバイス層）140 を形成し、その後、被転写層（薄膜デバイス層）140 を二次転写体 200 に転写するため、二次転写体 200 に要求される特性、特に耐熱性は、被転写層（薄膜デバイス層）140 の形成の際の温度条件等に依存しないからである。この点は、一次転写体 190 についても同様である。

【0146】したがって、被転写層 140 の形成の際の最高温度を T_{max} としたとき、一次、二次転写体 190、200 の構成材料として、ガラス転移点 (T_g) または軟化点が T_{max} 以下のものを用いることができる。例えば、一次、二次転写体 190、200 は、ガラス転移点 (T_g) または軟化点が好ましくは 800℃ 以下、より好ましくは 500℃ 以下、さらに好ましくは 320℃ 以下の材料で構成することができる。

【0147】また、一次、二次転写体 190、200 の機械的特性としては、ある程度の剛性（強度）を有するものが好ましいが、可撓性、弾性を有するものであってもよい。

【0148】このような一次、二次転写体 190、200 の構成材料としては、各種合成樹脂または各種ガラス材が挙げられ、特に、各種合成樹脂や通常の（低融点の）安価なガラス材が好ましい。

【0149】合成樹脂としては、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂のいずれでもよく、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン-ブレンデン共重合体、エチレン-酢酸ビニル共重合体 (EVA) 等のポリオレフィン、環状ポリオレフィン、変性ポリオレフィン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリスチレン、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリカーボネート、ポリ（4-メチルペンテン-1）、アイオノマー、アクリル系樹脂、ポリメチルメタクリレート、アクリル-スチレン共重合体 (AS 樹脂)、ブタジエンス

チレン共重合体、ポリオ共重合体 (EVOH)、ポリエチレンテレフタレート (PET)、ポリブチレンテレフタレート (PBT)、ポリシクロヘキサントテレフタレート (PCT) 等のポリエステル、ポリエーテル、ポリエーテルケトン (PEK)、ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)、ポリエーテルイミド、ポリアセタール (POM)、ポリフェニレンオキシド、変性ポリフェニレンオキシド、ポリアリレート、芳香族ポリエステル（液晶ポリマー）、ポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデン、その他フッ素系樹脂、スチレン系、ポリオレフィン系、ポリ塩化ビニル系、ポリウレタン系、フッ素ゴム系、塩素化ポリエチレン系等の各種熱可塑性エラストマー、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル、シリコーン樹脂、ポリウレタン等、またはこれらを主とする共重合体、ブレンド体、ポリマーアロイ等が挙げられ、これらのうちの 1 種または 2 種以上を組み合わせ（例えば 2 層以上の積層体として）用いることができる。

【0150】ガラス材としては、例えば、ケイ酸ガラス（石英ガラス）、ケイ酸アルカリガラス、ソーダ石灰ガラス、カリ石灰ガラス、鉛（アルカリ）ガラス、バリウムガラス、ホウケイ酸ガラス等が挙げられる。このうち、ケイ酸ガラス以外のものは、ケイ酸ガラスに比べて融点が低く、また、成形、加工も比較的容易であり、しかも安価であり、好ましい。

【0151】二次転写体 200 として合成樹脂で構成されたものを用いる場合には、大型の二次転写体 200 を一体的に成形することができるとともに、湾曲面や凹凸を有するもの等の複雑な形状であっても容易に製造することができ、また、材料コスト、製造コストも安価であるという種々の利点が享受できる。したがって、合成樹脂の使用は、大型で安価なデバイス（例えば、液晶ディスプレイ）を製造する上で有利である。

【0152】なお、二次転写体 200 は、例えば、液晶セルのように、それ自体独立したデバイスを構成するものや、例えばカラーフィルター、電極層、誘電体層、絶縁層、半導体素子のように、デバイスの一部を構成するものであってもよい。

【0153】さらに、一次、二次転写体 190、200 は、金属、セラミックス、石材、木材紙等の物質であってもよいし、ある品物を構成する任意の面上（時計の面上、エアコンの表面上、プリント基板の上等）、さらには壁、柱、天井、窓ガラス等の構造物の表面上であってもよい。

【0154】[工程 8]次に、図 8 に示すように、第 2 分離層である熱溶融性接着層 160 を加熱し、熱溶融させる。この結果、熱溶融性接着層 160 の接着力が弱まるため、一次転写体 180 を、薄膜デバイス層 140 により離脱させることができる。なお、一次転写体 180 に付着した熱溶融性接着剤を除去することで、この一次転

写体180を繰り返し再利用することができる。

【0155】[工程9]最後に、薄膜デバイス層140の表面に付着した熱溶融性接着層160を除去することで、図9に示すように、二次転写体200に転写された薄膜デバイス層140を得ることができる。ここで、この二次転写体200に対する薄膜デバイス層140の積層関係は、図2に示すように当初の基板100に対する薄膜デバイス層140の積層関係と同じとなる。

【0156】以上のような各工程を経て、被転写層（薄膜デバイス層）140の二次転写体200への転写が完了する。その後、被転写層（薄膜デバイス層）140に隣接するSiO₂膜の除去や、被転写層140上への配線等の導電層や所望の保護膜の形成等を行うこともできる。

【0157】本発明では、被剥離物である被転写層（薄膜デバイス層）140自体を直接に剥離するのではなく、第1分離層120及び第2分離層160において分離して二次転写体200に転写するため、被分離物（被転写層140）の特性、条件等にかかわらず、容易かつ確実に、しかも均一に転写することができ、分離操作に伴う被分離物（被転写層140）へのダメージもなく、被転写層140の高い信頼性を維持することができる。

【0158】（第2の実施の形態）基板上にCMOS構造のTFTを形成し、これを転写体に転写する場合の具体的な製造プロセスの例を図11～図21を用いて説明する。

【0159】（工程1）図11に示すように、基板（例えば石英基板）100上に、第1分離層（例えば、LPCVD法により形成されたアモルファスシリコン層）120と、中間層（例えば、SiO₂膜）142と、アモルファスシリコン層（例えばLPCVD法により形成される）143とを順次に積層形成し、続いて、アモルファスシリコン層143の全面に上方からレーザー光を照射し、アニールを施す。これにより、アモルファスシリコン層143は再結晶化してポリシリコン層となる。

【0160】（工程2）続いて、図12に示すように、レーザーアニールにより得られたポリシリコン層をパターンニングして、アイランド144a、144bを形成する。

【0161】（工程3）図13に示されるように、アイランド144a、144bを覆うゲート絶縁膜148a、148bを、例えば、CVD法により形成する。

【0162】（工程4）図14に示されるように、ポリシリコンあるいはメタル等からなるゲート電極150a、150bを形成する。

【0163】（工程5）図15に示すように、ポリイミド等からなるマスク層170を形成し、ゲート電極150bおよびマスク層170をマスクとして用い、セルフアラインで、例えばボロン（B）のイオン注入を行う。これによって、p⁺層172a、172bが形成され

る。

【0164】（工程6）図16に示すように、ポリイミド等からなるマスク層174を形成し、ゲート電極150aおよびマスク層174をマスクとして用い、セルフアラインで、例えばリン（P）のイオン注入を行う。これによって、n⁺層146a、146bが形成される。

【0165】（工程7）図17に示すように、層間絶縁膜154を形成し、選択的にコンタクトホール形成後、電極152a～152dを形成する。

【0166】このようにして形成されたCMOS構造のTFTが、図2～図9における被転写層（薄膜デバイス層）140に該当する。なお、層間絶縁膜154上に保護膜を形成してもよい。

【0167】（工程8）図18に示すように、CMOS構成のTFT上に、第2分離層としての熱溶融性接着層160を形成する。このとき、TFTの表層に生じていた段差が、熱溶融性接着剤160により平坦化される。なお、第2分離層は、第1分離層と同様にアブレーション層で構成することもできる。

【0168】ここで、薄膜デバイスであるTFT上にまず絶縁層などの保護層を形成し、その保護層上に第2分離層を設けることが好ましい。特に、第2分離層をアブレーション層とした場合に、アブレーション時に保護層により薄膜デバイス層を保護することができる。

【0169】また、特に第2分離層をアブレーション層にて形成する場合には、その第2分離層自体を第1分離層と同様に多層にて形成することもできる。さらに、この第2分離層と薄膜デバイス層との間に、金属層等の遮光層を設けるとさらに良い。アブレーション時に、薄膜デバイス層に光が入射することを防止できるからである。

【0170】この第2分離層形成後に、第2分離層である熱溶融性接着層160を介して、TFTを一次転写体（例えば、ソーダガラス基板）180に貼り付ける。

【0171】（工程9）図19に示すように、基板100の裏面から、例えば、Xe-Clエキシマレーザー光を照射する。これにより、第1分離層120の層内および／または界面において剥離を生じせしめる。

【0172】（工程10）図20に示すように、基板100を引き剥がす。

【0173】（工程11）さらに、第1分離層120をエッチングにより除去する。これにより、図21に示すように、CMOS構成のTFTが、一次転写体180に転写されたことになる。

【0174】（工程12）次に、図22に示すように、CMOS構成のTFTの下面に、熱溶融性樹脂層160よりも硬化点が低い接着層として、例えばエポキシ樹脂層190を形成する。次に、そのエポキシ樹脂層190を介して、TFTを二次転写体（例えば、ソーダガラス

基板) 200に貼り付ける。続いて、熱を加えてエポキシ樹脂層190を硬化させ、二次転写体200とTFTとを接着(接合)する。

【0175】(工程13)次に、図23に示すように例えばオープン210を用いて熱溶融性樹脂層160を熱により溶融させ、この熱溶融性樹脂層160を境にして、TFTを二次転写体180より引き剥がす。さらに、TFTの下面に残存している熱溶融性樹脂層160を、例えばキシレンなどにより除去する。これにより、図24に示すように、TFTが二次転写体200に転写される。この図24の状態は、図17に示す基板100及び第1分離層120を、二次転写体200及び接着層190に置き換えたものと同じとなる。従って、TFTの製造工程に用いた基板100に対する積層関係が、二次転写体200上に確保される。このため、電極152a~152dが露出され、それへのコンタクトあるいは配線を容易に行うことができる。なお、図24の状態とした後に、その表層に保護層を形成しても良い。

【0176】(第3の実施の形態) 上述の第1の実施の形態および第2の実施の形態で説明した技術を用いると、例えば、図25(a)に示すような、薄膜デバイスを用いて構成されたマイクロコンピュータを所望の基板上に形成できるようになる。

【0177】図25(a)では、プラスチック等からなる二次転写体としてのフレキシブル基板182上に、薄膜デバイスを用いて回路が構成されたCPU300、RAM320、入出力回路360ならびに、これらの回路の電源電圧を供給するための、アモルファスシリコンのPIN接合を具備する太陽電池340が搭載されている。

【0178】図25(a)のマイクロコンピュータは二次転写体であるフレキシブル基板182上に形成されているため、図25(b)に示すように曲げに強く、また、軽量であるために落下にも強いという特徴がある。また、図25(a)に示すプラスチック基板182は、電子機器のケースを兼用しても良い。こうすると、ケースの内面および外面の少なくとも一方に薄膜デバイスが転写された電子機器を製造できる。

【0179】(第4の実施の形態) 本実施の形態では、上述の薄膜デバイスの転写技術を用いて、図26に示されるような、アクティブマトリクス基板を用いたアクティブマトリクス型の液晶表示装置を作成する場合の製造プロセスの例について説明する。

【0180】(液晶表示装置の構成) 図26に示すように、アクティブマトリクス型の液晶表示装置は、バックライト等の照明光源400、偏光板420、アクティブマトリクス基板440、液晶460、対向基板480、偏光板500を具備する。

【0181】なお、本発明のアクティブマトリクス基板440と対向基板480にプラスチックフィルムのように

なフレキシブル基板を用いる場合は、照明光源400に代えて反射板を採用した反射型液晶パネルとして構成すると、可撓性があるため衝撃に強くかつ軽量のアクティブマトリクス型液晶パネルを実現できる。なお、画素電極を金属で形成した場合、反射板および偏光板420は不要となる。

【0182】本実施の形態で使用するアクティブマトリクス基板440は、画素部442にTFTを配置し、さらに、ドライバ回路(走査線ドライバおよびデータ線ドライバ)444を搭載したドライバ内蔵型のアクティブマトリクス基板である。

【0183】このアクティブマトリクス型液晶表示装置の要部の断面図が図27に示され、また、液晶表示装置の要部の回路構成が図28に示される。

【0184】図28に示されるように、画素部442は、ゲートがゲート線G1に接続され、ソース・ドレインの一方がデータ線D1に接続され、ソース・ドレインの他方が液晶460に接続されたTFT(M1)と、液晶460を含む。

【0185】また、ドライバ部444は、画素部のTFT(M1)と同じプロセスにより形成されるTFT(M2)を含んで構成される。

【0186】図27の左側に示されるように、画素部442におけるTFT(M1)は、ソース・ドレイン層1100a、1100bと、チャンネル1100eと、ゲート絶縁膜1200aと、ゲート電極1300aと、絶縁膜1500と、ソース・ドレイン電極1400a、1400bとを含んで構成される。

【0187】なお、参照番号1700は画素電極であり、参照番号1702は画素電極1700が液晶460に電圧を印加する領域(液晶への電圧印加領域)を示す。図中、配向膜は省略してある。画素電極1700はITO(光透過型の液晶パネルの場合)あるいはアルミニウム等の金属(反射型の液晶パネルの場合)により構成される。

【0188】また、図27の右側に示されるように、ドライバ部444を構成するTFT(M2)は、ソース・ドレイン層1100c、1100dと、チャンネル1100fと、ゲート絶縁膜1200bと、ゲート電極1300bと、絶縁膜1500と、ソース・ドレイン電極1400c、1400dとを含んで構成される。

【0189】なお、図27において、参照番号480は、例えば、対向基板(例えば、ソーダガラス基板)であり、参照番号482は共通電極である。また、参照番号1000はSiO₂膜であり、参照番号1600は層間絶縁膜(例えば、SiO₂膜)であり、参照番号1800は接着層である。また、参照番号1900は、例えばソーダガラス基板からなる基板(転写体)である。

【0190】(液晶表示装置の製造プロセス) 以下、図27の液晶表示装置の製造プロセスについて、図29~

図34を参照して説明する。

【0191】まず、図11～図21と同様の製造プロセスを経て、図29のようなTFT (M1, M2) を、信頼性が高くかつレーザー光を透過する基板（例えば、石英基板）3000上に形成し、保護膜1600を構成する。なお、図29において、参照番号3100は第1分離層（レーザー吸収層）である。また、図29では、TFT (M1, M2) は共にn型のMOSFETとしている。但し、これに限定されるものではなく、p型のMOSFETや、CMOS構造としてもよい。

【0192】次に、図30に示すように、保護膜1600を選択的にエッチングし、電極1400aに導通するITO膜あるいはアルミニウム等の金属からなる画素電極1700を形成する。ITO膜を用いる場合には透過型の液晶パネルとなり、アルミニウム等の金属を用いる場合には反射型の液晶パネルとなる。

【0193】次に、図31に示すように、第2分離層である熱溶融性接着層1800を介して、一次転写体である基板1900を接合（接着）する。なお、第2分離層は、第1分離層と同様にアブレーション層で構成することもできる。

【0194】次に、図31に示すように、基板3000の裏面からエキシマレーザー光を照射し、この後、基板3000を引き剥がす。

【0195】次に、第1分離層（レーザー吸収層）3100を除去する。これにより、図32に示すように、画素部442及びドライバ部44は、一次転写体1900に転写される。

【0196】次に、図33に示すように、熱硬化性接着層2000を介して、二次転写体2100を、SiO₂膜1000の下面に接合する。

【0197】その後、例えば一次転写体1900をオープン上に載置して、熱溶融性接着剤1800を溶融させ、一次転写体1900を離脱させる。保護膜1600及び画素電極1700に付着している熱溶融性接着層1900も除去する。

【0198】これにより、図34に示すように、二次転写体2100に転写されたアクティブマトリクス基板440が完成する。画素電極1700は表層より露出しており、液晶との電氣的な接続が可能となっている。この後、アクティブマトリクス基板440の絶縁膜（SiO₂などの中間層）1000の表面および画素電極1700の表面に配向膜を形成して配向処理が施される。図34では、配向膜は省略してある。

【0199】そしてさらに、図27に示すように、その表面に画素電極1700と対向する共通電極が形成され、その表面が配向処理された対向基板480と、アクティブマトリクス基板440とを封止材（シール材）で封止し、両基板の間に液晶を封入して、液晶表示装置が完成する。

【0200】（第5の実施の形態）図35に本発明の第5の実施の形態を示す。

【0201】本実施の形態では、上述の薄膜デバイスの転写方法を複数回実行して、転写元の基板よりも大きい基板（転写体）上に薄膜デバイスを含む複数のパターンを転写し、最終的に大規模なアクティブマトリクス基板を形成する。

【0202】つまり、大きな基板7000上に、複数回の転写を実行し、画素部7100a～7100pを形成する。図35の上側に一点鎖線で囲んで示されるように、画素部には、TFTや配線が形成されている。図35において、参照番号7210は走査線であり、参照番号7200は信号線であり、参照番号7220はゲート電極であり、参照番号7230は画素電極である。

【0203】信頼性の高い基板を繰り返し使用し、あるいは複数の第1の基板を使用して薄膜パターンの転写を複数回実行することにより、信頼性の高い薄膜デバイスを搭載した大規模なアクティブマトリクス基板を作成できる。

【0204】（第6の実施の形態）本発明の第6の実施の形態を図36に示す。

【0205】本実施の形態の特徴は、上述の薄膜デバイスの転写方法を複数回実行して、転写元の基板上よりも大きな基板上に、設計ルール（つまりパターン設計する上でのデザインルール）が異なる薄膜デバイス（つまり、最小線幅が異なる薄膜デバイス）を含む複数のパターンを転写することである。

【0206】図36では、ドライバ搭載のアクティブマトリクス基板において、画素部（7100a～7100p）よりも、より微細な製造プロセスで作成されたドライバ回路（8000～8032）を、複数回の転写によって基板6000の周囲に作成してある。

【0207】ドライバ回路を構成するシフトレジスタは、低電圧下においてロジックレベルの動作をするので画素TFTよりも耐圧が低くてよく、よって、画素TFTより微細なTFTとなるようにして高集積化を図ることができる。

【0208】本実施の形態によれば、設計ルールレベルの異なる（つまり製造プロセスが異なる）複数の回路を、一つの基板上に実現できる。なお、シフトレジスタの制御によりデータ信号をサンプリングするサンプリング手段（図25の薄膜トランジスタM2）は、画素TFT同様に高耐圧が必要なので、画素TFTと同一プロセス／同一設計ルールで形成するとよい。

【0209】（第7の実施の形態）図37、図38は、第1の実施の形態にて用いた第2分離層としての熱溶融性接着層160に代えて、第1の実施の形態の第1分離層120と同じ例えばアモルファスシリコン層220を用いた変形例を示している。図37に示すように、このアモルファスシリコン層220の上に、接着層230を

介して一次転写体180が接合されている。また、図37は第1分離層120にてアブレーションを生じさせるための光照射工程を示し、これは図4の工程と対応している図37の光照射工程の後に基板100及び第1分離層120を、薄膜デバイス層140の下面より除去し、図38に示すように、接着層190を介して二次転写体200を接合する。この後に、図38に示すように、例えば一次転写体180側からアモルファスシリコン層220に光照射する。これにより、アモルファスシリコン層220にてアブレーションが生ずる。この結果、一次転写体180及び接着層230を、薄膜デバイス層140から除去することができる。

【0210】このように、本発明では第1、第2分離層の双方にて順次アブレーションを生じさせて、薄膜デバイス層140を二次転写体200に転写させても良い。

【0211】

【実施例】次に、本発明の具体的実施例について説明する。

【0212】（実施例1）縦50mm×横50mm×厚さ1.1mmの石英基板（軟化点：1630℃、歪点：1070℃、エキシマレーザの透過率：ほぼ100%）を用意し、この石英基板の片面に、第1分離層（レーザ光吸収層）として非晶質シリコン（a-Si）膜を低圧CVD法（Si₂H₆ガス、425℃）により形成した。第1分離層の膜厚は、100nmであった。

【0213】次に、第1分離層上に、中間層としてSiO₂膜をECR-CVD法（SiH₄+O₂ガス、100℃）により形成した。中間層の膜厚は、200nmであった。

【0214】次に、中間層上に、被転写層として膜厚50nmの非晶質シリコン膜を低圧CVD法（Si₂H₆ガス、425℃）により形成し、この非晶質シリコン膜にレーザ光（波長308nm）を照射して、結晶化させ、ポリシリコン膜とした。その後、このポリシリコン膜に対し、所定のパターンニングを施し、薄膜トランジスタのソース・ドレイン・チャネルとなる領域を形成した。この後、1000℃以上の高温によりポリシリコン膜表面を熱酸化してゲート絶縁膜SiO₂を形成した後、ゲート絶縁膜上にゲート電極（ポリシリコンにMo等の高融点金属が積層形成された構造）を形成し、ゲート電極をマスクとしてイオン注入することによって、自己整合的（セルフアライン）にソース・ドレイン領域を形成し、薄膜トランジスタを形成した。この後、必要に応じて、ソース・ドレイン領域に接続される電極及び配線、ゲート電極につながる配線が形成される。これらの電極や配線にはAlが使用されるが、これに限定されるものではない。また、後工程のレーザ照射によりAlの溶融が心配される場合は、Alよりも高融点の金属（後工程のレーザ照射により溶融しないもの）を使用してもよい。

【0215】次に、前記薄膜トランジスタの上に、熱溶融性接着剤（商品名：ブルーフックス）を塗布し、一次転写体として縦200mm×横300mm×厚さ1.1mmの大型の透明なガラス基板（ソーダガラス、軟化点：740℃、歪点：511℃）を接合した。

【0216】次に、Xe-C1エキシマレーザ（波長：308nm）を石英基板側から照射し、第1分離層に剥離（層内剥離および界面剥離）を生じさせた。照射したXe-C1エキシマレーザのエネルギー密度は、250mJ/cm²、照射時間は、20nsecであった。なお、エキシマレーザの照射は、スポットビーム照射とラインビーム照射とがあり、スポットビーム照射の場合は、所定の単位領域（例えば8mm×8mm）にスポット照射し、このスポット照射を単位領域の1/10程度ずつずらしながら照射していく。また、ラインビーム照射の場合は、所定の単位領域（例えば378mm×0.1mmや378mm×0.3mm（これらはエネルギーの90%以上が得られる領域））を同じく1/10程度ずつずらしながら照射していく。これにより、第1分離層の各点は少なくとも10回の照射を受ける。このレーザ照射は、石英基板全面に対して、照射領域をずらしながら実施される。

【0217】この後、石英基板とガラス基板一次（転写体）とを第1分離層において引き剥がし、石英基板上に形成された薄膜トランジスタおよび中間層を、一次転写体であるガラス基板側に一次転写した。

【0218】その後、ガラス基板側の中間層の表面に付着した第1分離層を、エッチングや洗浄またはそれらの組み合わせにより除去した。また、石英基板についても同様の処理を行い、再使用に供した。

【0219】さらに、露出した中間層の下面に、紫外線硬化型接着剤を塗布し（膜厚：100μm）、さらにその塗膜に、二次転写体として縦200mm×横300mm×厚さ1.1mmの大型の透明なガラス基板（ソーダガラス、軟化点：740℃、歪点：511℃）を接合した後、ガラス基板側から紫外線を照射して接着剤を硬化させ、これらを接着固定した。

【0220】その後、熱溶融性接着剤を熱溶融させ、一次転写体であるガラス基板を除去した。これにより、薄膜トランジスタおよび中間層を、二次転写体であるガラス基板側に二次転写した。なお、一次転写体も洗浄により再利用可能である。

【0221】ここで、一次転写体となるガラス基板が石英基板より大きな基板であれば、本実施例のような石英基板からガラス基板への一次転写を、平面的に異なる領域に繰り返して実施し、ガラス基板上に、石英基板に形成可能な薄膜トランジスタの数より多くの薄膜トランジスタを形成することができる。さらに、ガラス基板上に繰り返し積層し、同様により多くの薄膜トランジスタを形成することができる。あるいは、二次転写体となるガラス基板を、一次転写体及び石英基板よりも大型基板と

し、二次転写を繰り返し実施して、石英基板に形成可能な薄膜トランジスタの数より多くの薄膜トランジスタを形成することもできる。

【0222】（実施例2）第1分離層を、H（水素）を20at%含有する非晶質シリコン膜とした以外は実施例1と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0223】なお、非晶質シリコン膜中のH量の調整は、低圧CVD法による成膜時の条件を適宜設定することにより行った。

【0224】（実施例3）第1分離層を、スピコートによりゾルーゲル法で形成したセラミックス薄膜（組成： $PbTiO_3$ 、膜厚：200nm）とした以外は実施例1と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0225】（実施例4）第1分離層を、スパッタリングにより形成したセラミックス薄膜（組成： $BaTiO_3$ 、膜厚：400nm）とした以外は実施例1と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0226】（実施例5）第1分離層を、レーザーアブレーション法により形成したセラミックス薄膜（組成： $Pb(Zr, Ti)O_3$ （PZT）、膜厚：50nm）とした以外は実施例1と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0227】（実施例6）第1分離層を、スピコートにより形成したポリイミド膜（膜厚：200nm）とした以外は実施例1と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0228】（実施例7）第1分離層を、スピコートにより形成したポリフェニレンサルファイド膜（膜厚：200nm）とした以外は実施例1と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0229】（実施例8）第1分離層を、スパッタリングにより形成したAl層（膜厚：300nm）とした以外は実施例1と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0230】（実施例9）照射光として、Kr-Fエキシマレーザ（波長：248nm）を用いた以外は実施例2と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。なお、照射したレーザのエネルギー密度は、250mJ/cm²、照射時間は、20nsecであった。

【0231】（実施例10）照射光として、Nd-YAGレーザ（波長：1068nm）を用いた以外は実施例2と同様にして薄膜トランジスタの転写を行った。なお、照射したレーザのエネルギー密度は、400mJ/cm²、照射時間は、20nsecであった。

【0232】（実施例11）被転写層として、高温プロセス1000℃によるポリシリコン膜（膜厚80nm）の薄膜トランジスタとした以外は実施例1と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0233】（実施例12）転写体として、ポリカーボネート（ガラス転移点：130℃）製の透明基板を用い

た以外は実施例1と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0234】（実施例13）転写体として、AS樹脂（ガラス転移点：70～90℃）製の透明基板を用いた以外は実施例2と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0235】（実施例14）転写体として、ポリメチルメタクリレート（ガラス転移点：70～90℃）製の透明基板を用いた以外は実施例3と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0236】（実施例15）転写体として、ポリエチレンテレフタレート（ガラス転移点：67℃）製の透明基板を用いた以外は、実施例5と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0237】（実施例16）転写体として、高密度ポリエチレン（ガラス転移点：77～90℃）製の透明基板を用いた以外は実施例6と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

（実施例17）転写体として、ポリアミド（ガラス転移点：145℃）製の透明基板を用いた以外は実施例9と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0238】（実施例18）転写体として、エポキシ樹脂（ガラス転移点：120℃）製の透明基板を用いた以外は実施例10と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0239】（実施例19）転写体として、ポリメチルメタクリレート（ガラス転移点：70～90℃）製の透明基板を用いた以外は実施例11と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0240】実施例1～19について、それぞれ、転写された薄膜トランジスタの状態を肉眼と顕微鏡とで視観察したところ、いずれも、欠陥やムラがなく、均一に転写がなされていた。

【0241】以上述べたように、本発明の転写技術を用いれば、基板に形成した積層順序を維持したまま、薄膜デバイス（被転写層）を種々の転写体へ二次転写することが可能となる。例えば、薄膜を直接形成することができないかまたは形成するのに適さない材料、成形が容易な材料、安価な材料等で構成されたものや、移動しにくい大型の物体等に対しても、転写によりそれを形成することができる。

【0242】特に、転写体は、各種合成樹脂や融点の低いガラス材のような、基板材料に比べ耐熱性、耐食性等の特性が劣るものを用いることができる。そのため、例えば、透明基板上に薄膜トランジスタ（特にポリシリコンTFT）を形成した液晶ディスプレイを製造するに際しては、基板として、耐熱性に優れた石英ガラス基板を用い、転写体として、各種合成樹脂や融点の低いガラス材のような安価でかつ加工のしやすい材料の透明基板を用いることにより、大型で安価な液晶ディスプレイを容易

に製造することができるようになる。このような利点は、液晶ディスプレイに限らず、他のデバイスの製造についても同様である。

【0243】また、以上のような利点を享受しつつも、信頼性の高い基板、特に石英ガラス基板のような耐熱性の高い基板に対し機能性薄膜のような被転写層を形成し、さらにはパターンニングすることができるので、転写体の材料特性にかかわらず、転写体上に信頼性の高い機能性薄膜を形成することができる。

【0244】また、このような信頼性の高い基板は、高価であるが、それを再利用することも可能であり、よって、製造コストも低減される。

【0245】また、本発明の別の形態によれば、上述した通り、必ずしも第1、第2分離層および一次、二次転写体を用いずに、一層の分離層および1つの転写体のみを用いて、保形性のある被転写層を基板より転写体側に転写することも可能である。被転写層自体に保形性を持たせるために、薄膜デバイス中の絶縁層を厚くしたり、あるいは補強層を形成することができる。

【0246】

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第1の実施の形態における第1の工程を示す断面図である。

【図2】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第1の実施の形態における第2の工程を示す断面図である。

【図3】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第1の実施の形態における第3の工程を示す断面図である。

【図4】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第1の実施の形態における第4の工程を示す断面図である。

【図5】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第1の実施の形態における第5の工程を示す断面図である。

【図6】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第1の実施の形態における第6の工程を示す断面図である。

【図7】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第1の実施の形態における第7の工程を示す断面図である。

【図8】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第1の実施の形態における第8の工程を示す断面図である。

【図9】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第1の実施の形態における第9の工程を示す断面図である。

【図10】第1の基板(図1の基板100)のレーザー光の波長に対する透過率の変化を示す図である。

【図11】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第2の実施の形態における第1の工程を示す断面図である。

【図12】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第2の実施の形態における第2の工程を示す断面図である。

【図13】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第2の実施の形態における第3の工程を示す断面図である。

【図14】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第2の実施の形態における第4の工程を示す断面図である。

【図15】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第2の実

施の形態における第5の工程を示す断面図である。

【図16】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第2の実施の形態における第6の工程を示す断面図である。

【図17】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第2の実施の形態における第7の工程を示す断面図である。

【図18】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第2の実施の形態における第8の工程を示す断面図である。

【図19】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第2の実施の形態における第9の工程を示す断面図である。

【図20】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第2の実施の形態における第10の工程を示す断面図である。

【図21】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第2の実施の形態における第11の工程を示す断面図である。

【図22】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第2の実施の形態における第12の工程を示す断面図である。

【図23】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第2の実施の形態における第13の工程を示す断面図である。

【図24】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第2の実施の形態における第14の工程を示す断面図である。

【図25】(a)、(b)は共に、本発明を用いて製造された第3の実施の形態に係るマイクロコンピュータの斜視図である。

【図26】本発明の第4の実施の形態に係る液晶表示装置の構成を説明するための図である。

【図27】図26の液晶表示装置の要部の断面構造を示す図である。

【図28】図26の液晶表示装置の要部の構成を説明するための図である。

【図29】本発明を用いたアクティブマトリクス基板の製造方法の第1の工程を示すデバイスの断面図である。

【図30】本発明を用いたアクティブマトリクス基板の製造方法の第2の工程を示すデバイスの断面図である。

【図31】本発明を用いたアクティブマトリクス基板の製造方法の第3の工程を示すデバイスの断面図である。

【図32】本発明を用いたアクティブマトリクス基板の製造方法の第4の工程を示すデバイスの断面図である。

【図33】本発明を用いたアクティブマトリクス基板の製造方法の第5の工程を示すデバイスの断面図である。

【図34】本発明を用いたアクティブマトリクス基板の製造方法の第5の工程を示すデバイスの断面図である。

【図35】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第5の実施の形態を説明するための図である。

【図36】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第6の実施の形態を説明するための図である。

【図37】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第7の実施の形態における第1光照射工程を説明するための図である。

【図38】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第7の実施の形態における第2光照射工程を説明するための図である。

【符号の説明】

100、3000 基板

120、3100 第1分離層

140、1000～1700 被転写層（薄膜デバイス層）

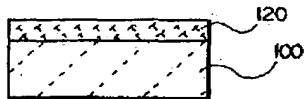
160、1800 第2分離層

18、1900 一次転写体

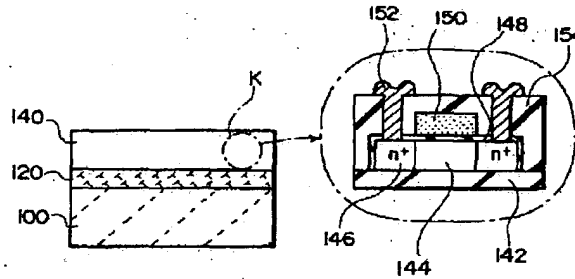
190、2000 接着層

200、2100 二次転写層

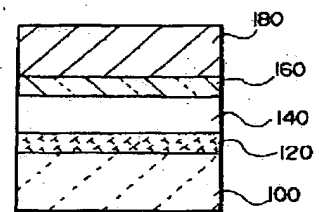
【図1】



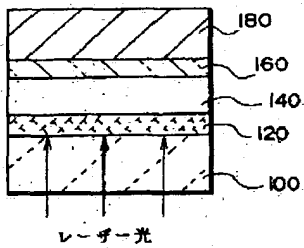
【図2】



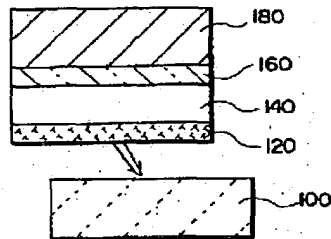
【図3】



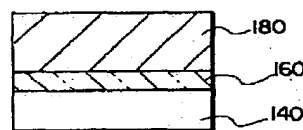
【図4】



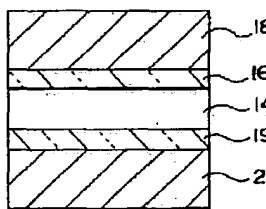
【図5】



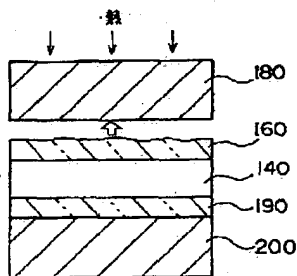
【図6】



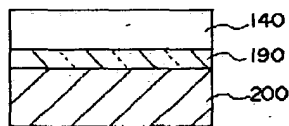
【図7】



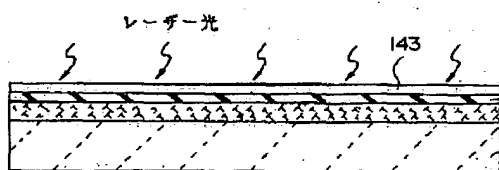
【図8】



【図9】



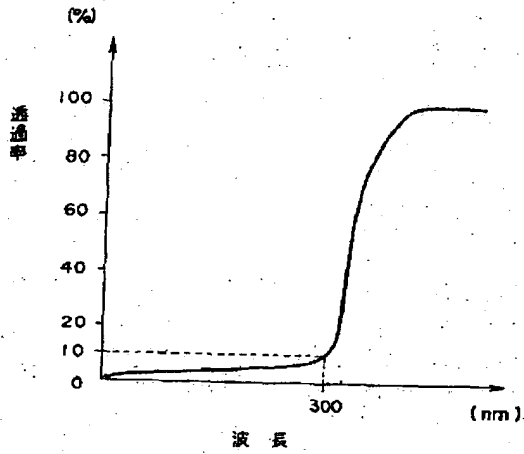
【図11】



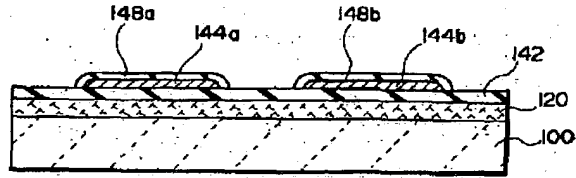
【図12】



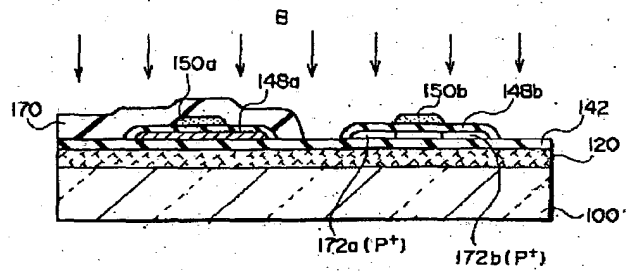
【図 10】



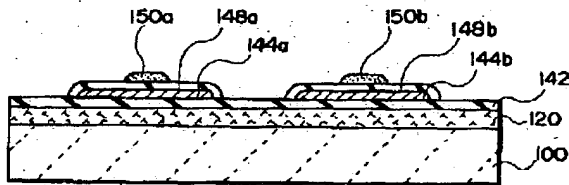
【図 13】



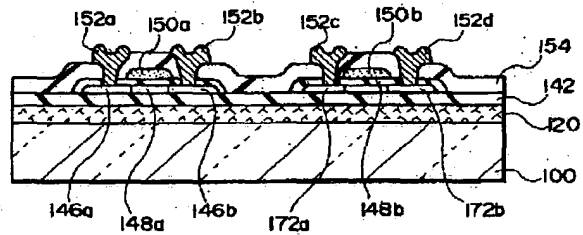
【図 15】



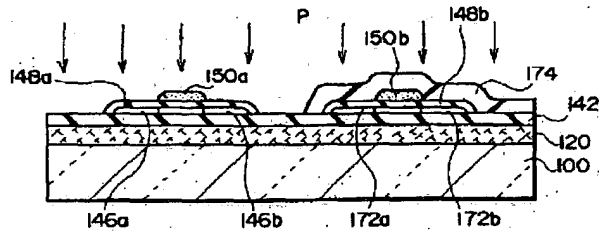
【図 14】



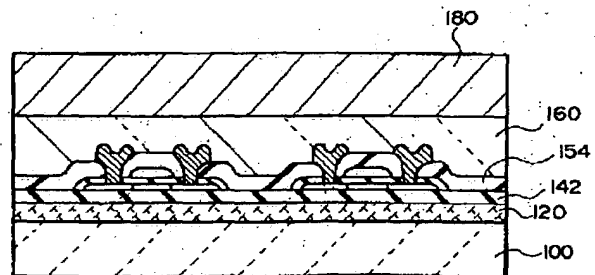
【図 17】



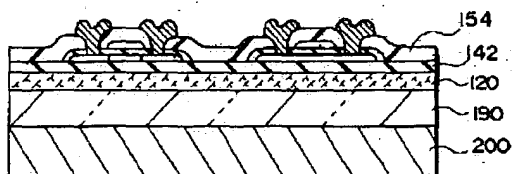
【図 16】



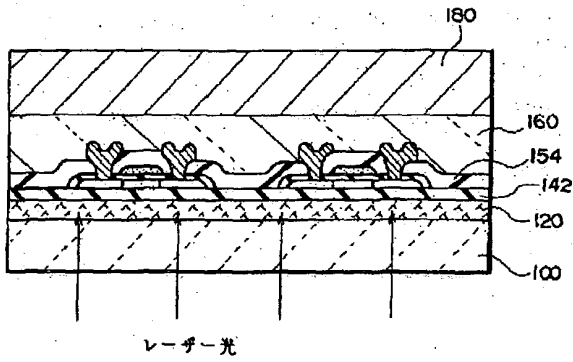
【図 18】



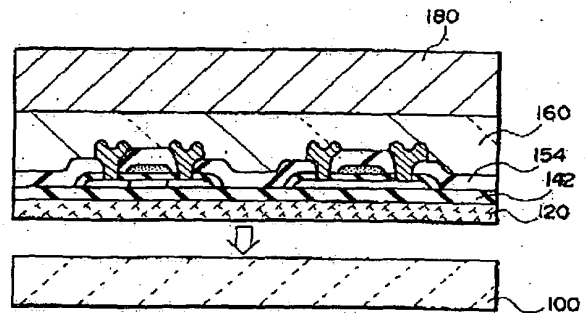
【図 24】



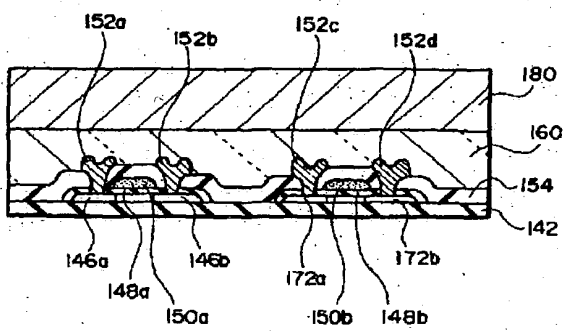
【図19】



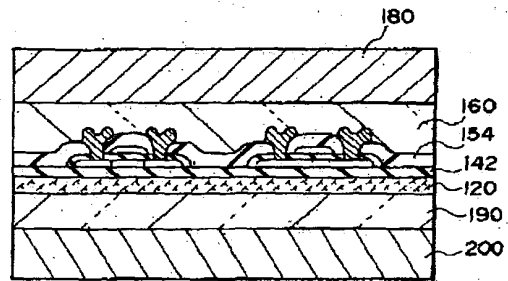
【図20】



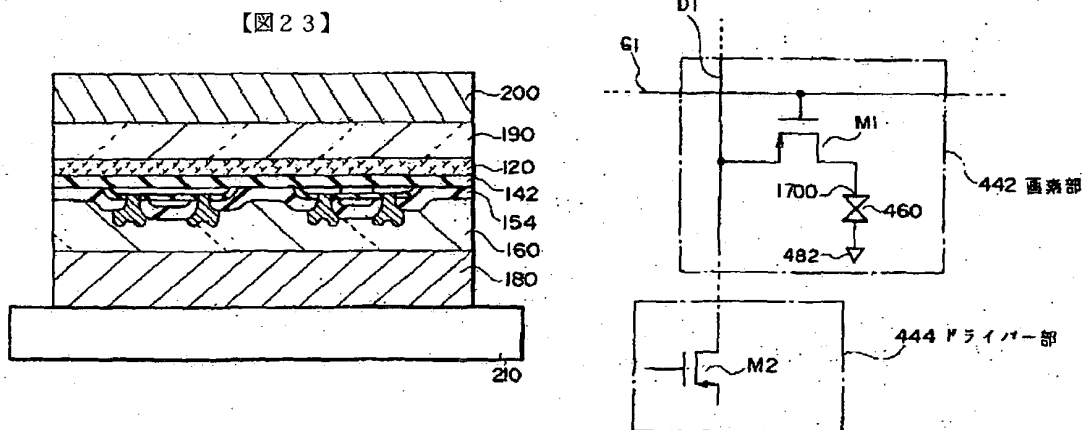
【図21】



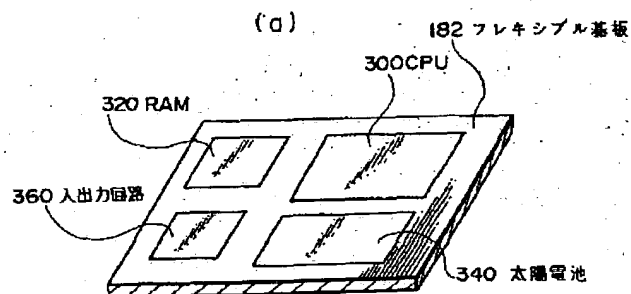
【図22】



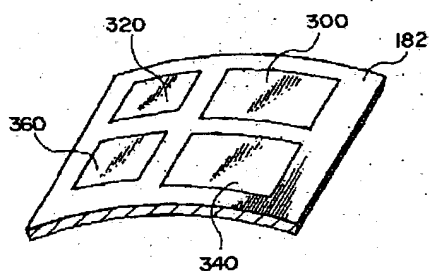
【図28】



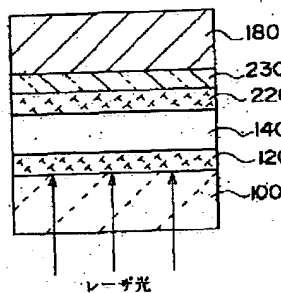
【図25】



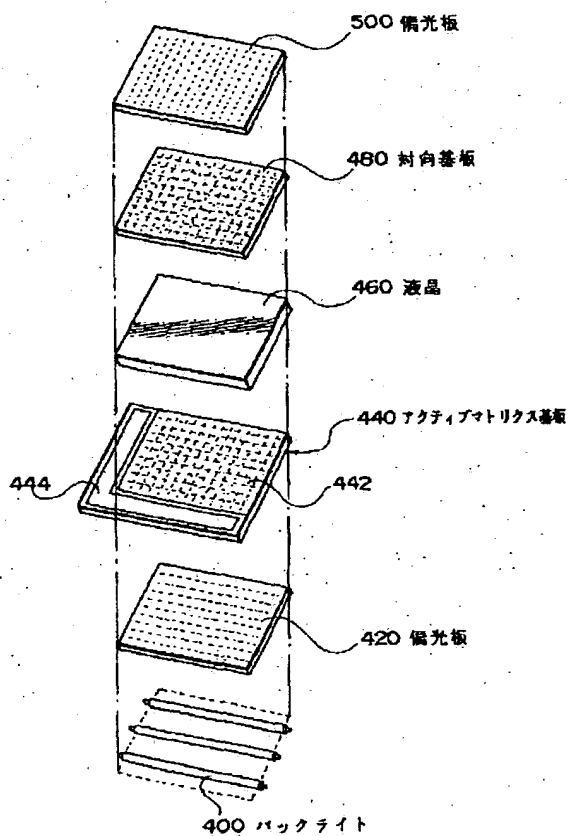
(b)



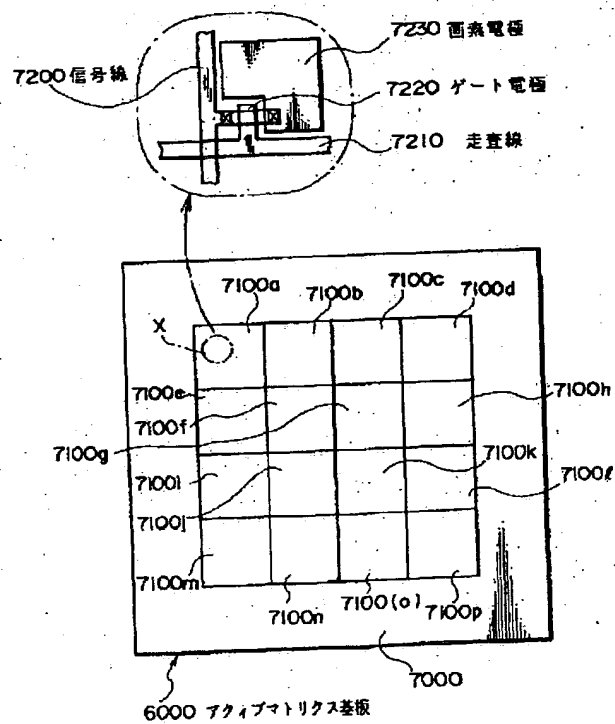
【図37】



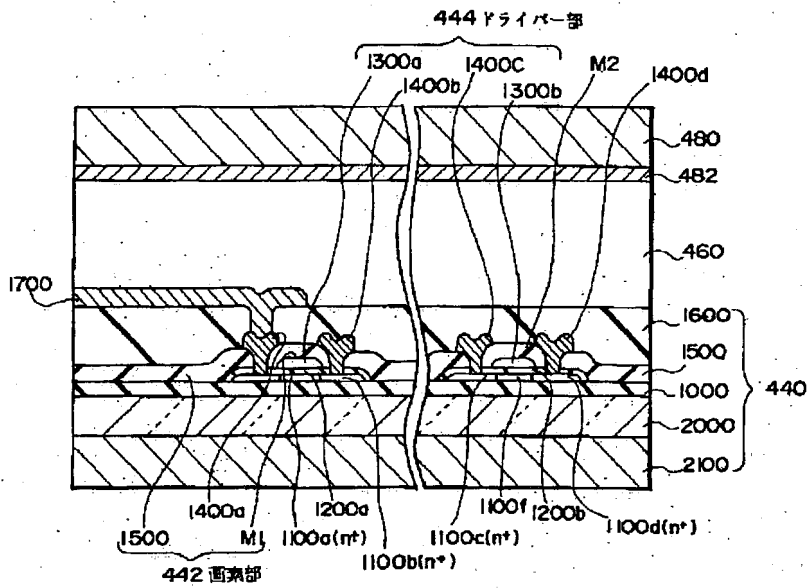
【図26】



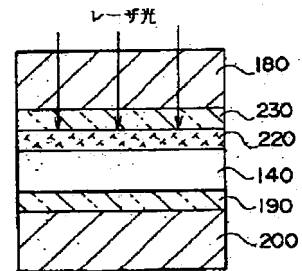
【図35】



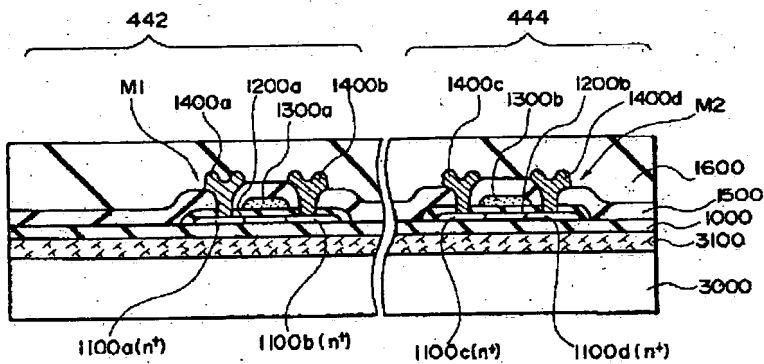
【図27】



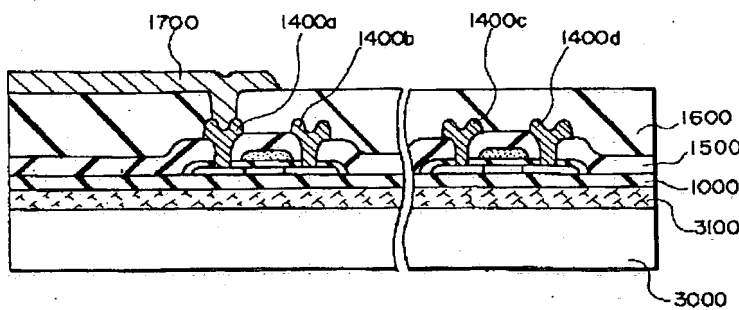
【図38】



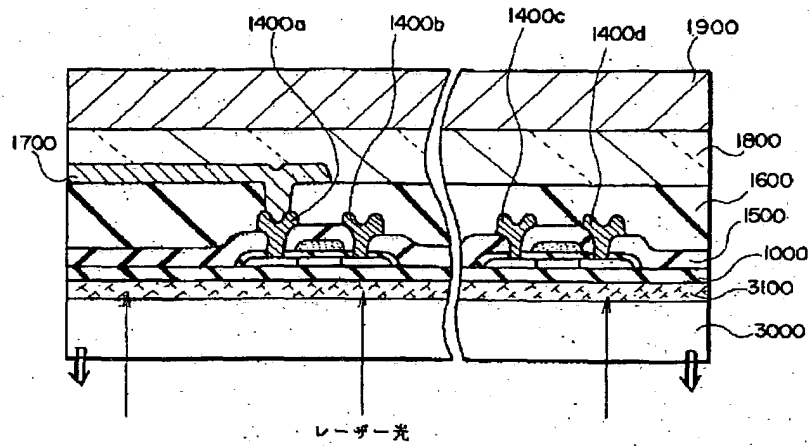
【図29】



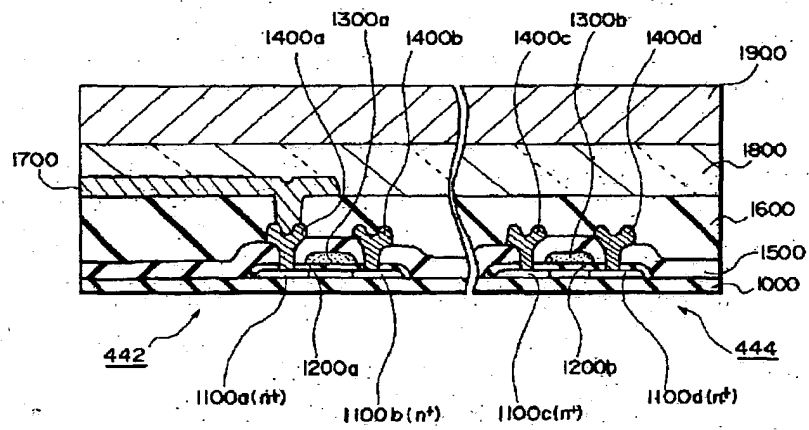
【図30】



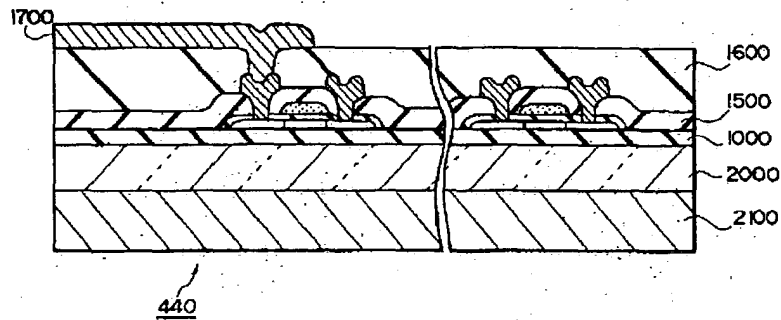
【図 3 1】



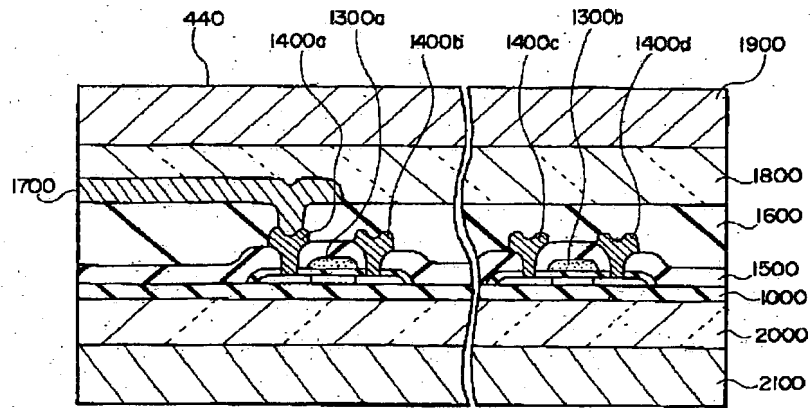
【図 3 2】



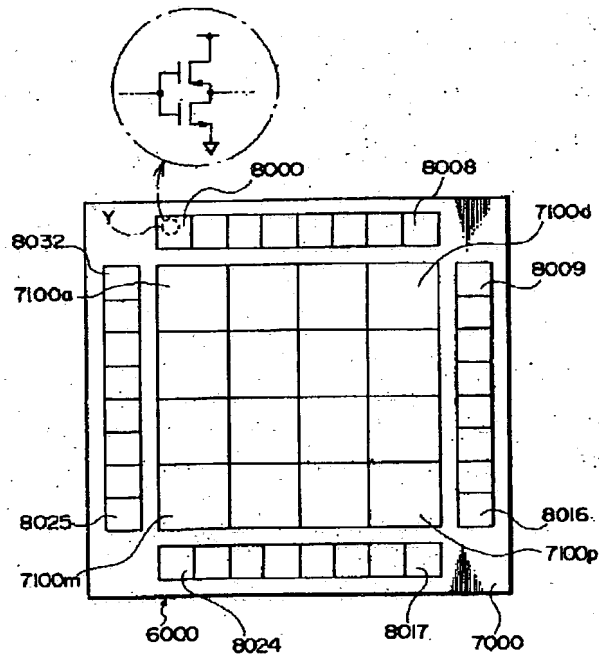
【図 3 4】



【図33】



【図36】



* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

JPA 11-026733

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

 CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The imprint method of the thin film device characterized by imprinting the aforementioned transferred layer characterized by providing the following on a secondary imprint object. The 1st process which forms the 1st detached core on a substrate. The 2nd process which forms the transferred layer containing a thin film device on the 1st detached core of the above. The 3rd process which forms the 2nd detached core on the aforementioned transferred layer. It has the 4th process which joins a primary imprint object on the 2nd detached core of the above, the 5th process which removes the aforementioned substrate from the aforementioned transferred layer bordering on the 1st detached core of the above, the 6th process which joins a secondary imprint object to the inferior surface of tongue of the aforementioned transferred layer, and the 7th process which remove the aforementioned primary imprint object from the aforementioned transferred layer bordering on the 2nd detached core of the above, and it is the aforementioned thin film device.

[Claim 2] It is the imprint method of the thin film device characterized by including the process which the 5th process of the above irradiates [process] light in a claim 1 at the 1st detached core of the above, and produces ablation in the inside of the layer of the 1st detached core of the above, and/or an interface.

[Claim 3] It is the imprint method of the thin film device which the aforementioned substrate is a substrate of a translucency and is characterized by performing optical irradiation to the 1st detached core of the above through the substrate of the aforementioned translucency in a claim 2.

[Claim 4] It is the imprint method of the thin film device characterized by for the 2nd detached core of the above being thermofusion nature adhesives, and the 5th process of the above including the process to which melting of the aforementioned thermofusion nature adhesives is carried out by heating in a claim 1 or either of 3.

[Claim 5] It is the imprint method of the thin film device characterized by including the process which the 7th process of the above irradiates [process] light in a claim 1 or either of 3 at the 2nd detached core of the above, and produces ablation in the inside of the layer of the 2nd detached core of the above, and/or an interface.

[Claim 6] It is the imprint method of the thin film device which the aforementioned primary imprint object is a translucency and is characterized by performing optical irradiation to the 2nd detached core of the above through the aforementioned primary imprint object of a translucency in a claim 5.

[Claim 7] It is the imprint method of the thin film device characterized by including the electrode formation process that the 2nd process of the above flows in this thin film device after formation of the aforementioned thin film device in a claim 1 or either of 6.

[Claim 8] It is the imprint method of the thin film device characterized by the aforementioned secondary imprint object being a transparent substrate in a claim 1 or either of 7.

[Claim 9] It is the imprint method of the thin film device characterized by a glass transition point (Tg) or softening temperature consisting of material below Above Tmax when the aforementioned secondary imprint object sets the maximum temperature in the case of formation of a transferred layer to Tmax in a

claim 1 or either of 8.

[Claim 10] The aforementioned secondary imprint object is the imprint method of a thin film device that a glass transition point (T_g) or softening temperature is characterized by being below the maximum temperature of the formation process of the aforementioned thin film device in a claim 1 or either of 8.

[Claim 11] It is the imprint method of the thin film device characterized by the aforementioned secondary imprint object consisting of synthetic resin or glass material in a claim 1 or either of 10.

[Claim 12] It is the imprint method of the thin film device characterized by the aforementioned substrate having thermal resistance in a claim 1 or either of 11.

[Claim 13] It is the imprint method of the thin film device characterized by the point [distortion] consisting of material beyond Above T_{max} when the aforementioned substrate sets the maximum temperature in the case of formation of a transferred layer to T_{max} in a claim 1 or either of 12.

[Claim 14] It is the imprint method of the thin film device characterized by the aforementioned thin film device containing TFT (TFT) in a claim 1 or either of 13.

[Claim 15] The imprint method of the thin film device which carries out multiple-times execution of the imprint method according to claim 1, and is characterized by imprinting two or more transferred layers on the aforementioned larger secondary imprint object than the aforementioned substrate in a claim 1 or either of 14.

[Claim 16] The imprint method of the thin film device which carries out multiple-times execution of the imprint method according to claim 1, and is characterized by imprinting two or more transferred layers from which the level of the design rule of a thin film device differs on the aforementioned secondary imprint object in a claim 1 or either of 14.

[Claim 17] The thin film device which the aforementioned secondary imprint object comes to imprint using the imprint method according to claim 1 to 16.

[Claim 18] Thin film integrated circuit equipment constituted including the thin film device imprinted by the aforementioned secondary imprint object using the imprint method according to claim 1 to 16.

[Claim 19] The active-matrix substrate which is an active-matrix substrate which the pixel section consists of including the TFT (TFT) arranged in the shape of a matrix, and the pixel electrode connected to the end of the TFT, and was manufactured by imprinting the TFT of the aforementioned pixel section using a method according to claim 1 to 16.

[Claim 20] The active-matrix substrate characterized by providing the following. TFT connected to the scanning line arranged in the shape of a matrix, and a signal line (TFT) TFT which is the active-matrix substrate which builds in the driver circuit for the pixel section being constituted including the pixel electrode connected to the end of the TFT, and supplying a signal to the aforementioned scanning line and the aforementioned signal line, and constitutes the TFT of the aforementioned pixel section of the 1st design rule level formed using the method according to claim 16, and the aforementioned driver circuit of the 2nd design rule level.

[Claim 21] The liquid crystal display manufactured using the active-matrix substrate according to claim 19 or 20.

[Claim 22] Electronic equipment characterized by having the thin film device which the aforementioned secondary imprint object comes to imprint using the imprint method according to claim 1 to 16.

[Claim 23] Electronic equipment which the aforementioned secondary imprint object is the case of a device, and is characterized by the aforementioned thin film device being imprinted by the inside of the aforementioned case, and one [at least] outside field in a claim 22.

[Claim 24] The imprint method of the thin film device characterized by imprinting the aforementioned transferred layer characterized by providing the following on the aforementioned imprint object. The 1st process which forms the 1st detached core on a substrate. The 2nd process which forms the transferred layer containing a thin film device on the 1st detached core of the above. The 3rd process which removes the aforementioned substrate from the aforementioned transferred layer bordering on the 1st detached core of the above. It has the 4th process which joins an imprint object to the inferior surface of tongue of the aforementioned transferred layer, and is the aforementioned thin film device.

[Translation done.]

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[The technical field to which invention belongs] this invention relates to the imprint method, the thin film device, the thin film integrated circuit equipment, the active-matrix substrate, the liquid crystal display, and electronic equipment of a thin film device.

[0002]

Background of the Invention] For example, it faces manufacturing the liquid crystal display using TFT (TFT), and passes through the process which forms TFT by CVD etc. on a substrate. Since the process which forms TFT on a substrate is accompanied by high temperature processing, a substrate needs to use what has the high thing, i.e., the softening temperature, and the high melting point of the quality of the material which is excellent in thermal resistance. Therefore, quartz glass is used as a substrate which bears the temperature of about 1000 degrees C now, and heat-resisting glass is used as a substrate which bears the temperature around 500 degrees C.

[0003]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] As mentioned above, the substrate in which a thin film device is carried must satisfy the conditions for manufacturing those thin film devices. That is, it is determined that the substrate to be used will surely fulfill the manufacture conditions of the device carried.

[0004] However, when its attention is paid only to the stage after the substrate in which thin film devices, such as TFT, were carried is completed, above-mentioned "substrate" is not sometimes necessarily desirable.

[0005] For example, although a quartz substrate, a heat-resisting glass substrate, etc. are used as mentioned above when passing through the manufacture process accompanied by high temperature processing, these are very expensive, therefore cause elevation of a product price.

[0006] Moreover, a glass substrate has the property for it to be heavy and to be easy to be divided. Although what cannot break easily even if it is cheap as much as possible, it is light and it bears and drops also on deformation of some is desirable in the liquid crystal display used for portable electronic equipment, such as a palm top computer and a portable telephone, actually, a glass substrate is heavy, and is weak to deformation, and it is common that there is fear of destruction by fall.

[0007] That is, it was very difficult for a slot to be between the desirable properties required of the restrictions which come from manufacture conditions, and a product, and to satisfy the conditions and property of these both sides to it.

[0008] Then, after this invention person etc. forms the transferred layer containing a thin film device on a substrate in the conventional process, he made the transferred layer containing this thin film device secede from a substrate, and has proposed the technology which an imprint object is made to imprint (Japanese Patent Application No. No. 225643 [eight to]). For this reason, the detached core is formed between a substrate and the thin film device which is a transferred layer. It makes it possible to make a transferred layer secede from a substrate by making the inside of the layer of a detached core, and/or an

interface exfoliate, and weakening the bonding strength of a substrate and a transferred layer by irradiating light at this detached core. Consequently, a transferred layer is imprinted by the imprint object. Here, although a thin film device is formed, when passing through the manufacture process accompanied by high temperature processing, a quartz substrate, a heat-resisting glass substrate, etc. are used. However, since an imprint object is not exposed to such high temperature processing, it has the advantage by which the restrictions called for as an imprint object are eased sharply.

[0009] By the way, if the transferred layer containing a thin film device secedes from the substrate used for manufacture of a thin film device and is imprinted by the imprint object, the relation between the laminating relation of the transferred layer to a substrate and the transferred layer to an imprint object will become reverse. That is, the whole surface of the transferred layer which had met the substrate side at the beginning will not meet an imprint object. When the case where a transferred layer consists of the 1st and a bilayer of the 2nd layer in this is explained, the transferred layer formed in order of the 1st layer and the 2nd layer on the substrate will be formed in order of the 2nd layer and the 1st layer on an imprint object.

[0010] Generally, when forming a thin film device on a substrate, an electrode is formed through an insulating layer after this element formation. Therefore, since this electrode is located in a surface side, the wiring to the electrode or contact is easy. However, if the transferred layer containing this thin film device and electrode is imprinted on an imprint object, an electrode will be covered by the imprint object and it will become difficult to this electrode wiring or to contact it.

[0011] this invention is made paying attention to such a trouble. one of the purpose of the With the substrate used at the time of manufacture of a thin film device, for example, the substrate (substrate with the property desirable in view of the use of a product) used at the time of real use of a product It is in making it possible to choose freely independently, maintaining the laminating relation of the thin film device to the substrate used at the time of manufacture as it is moreover, and offering the new technology which can be imprinted to the substrate which uses the thin film device at the time of real use.

[0012]

[Means for Solving the Problem] this invention which solves the technical problem mentioned above is carrying out the following composition.

[0013] The imprint method of the thin film device concerning invention according to claim 1 The 1st process which forms the 1st detached core on a substrate, and the 2nd process which forms the transferred layer containing a thin film device on the 1st detached core of the above, The 3rd process which forms the 2nd detached core on the aforementioned transferred layer, and the 4th process which joins a primary imprint object on the 2nd detached core of the above, The 5th process which removes the aforementioned substrate from the aforementioned transferred layer bordering on the 1st detached core of the above, It has the 6th process which joins a secondary imprint object to the inferior surface of tongue of the aforementioned transferred layer, and the 7th process which removes the aforementioned primary imprint object from the aforementioned transferred layer bordering on the 2nd detached core of the above, and is characterized by imprinting the aforementioned transferred layer containing the aforementioned thin film device on a secondary imprint object.

[0014] The 1st behind separable detached core with the high reliability in device manufacture is prepared, for example on substrates, such as a quartz substrate, and the transferred layer containing thin film devices, such as TFT, is formed on the substrate. Next, the 2nd behind separable detached core is formed on this transferred layer, and a primary imprint object is further joined on the 2nd detached core. It is made to secede from the substrate used bordering on the 1st detached core after that at the time of thin film device manufacture from a transferred layer. With this, the laminating relation of the transferred layer to the original substrate and the laminating relation of a transferred layer to a primary imprint object are reversed.

[0015] Then, after removing the 1st detached core from the inferior surface of tongue of a transferred layer preferably, a secondary imprint object is joined to the inferior surface of tongue. And it is made to secede from a primary imprint object from a transferred layer bordering on the 2nd detached core. If it

carries out like this, a secondary imprint object will exist in the place in which the original substrate was located to a transferred layer, and the laminating relation of the transferred layer to the original substrate and the laminating relation of a transferred layer to a secondary imprint object are in agreement.

[0016] In addition, the process which joins a secondary imprint object to the lower layer of a transferred layer, and the process which makes a primary imprint object secede from a transferred layer may not ask the sequence, but the point is sufficient as any. However, when a problem is in handling of the transferred layer after making it secede from a primary imprint object, it is desirable to carry out first the process which joins a transferred layer to a secondary imprint object, and to carry out the process made to secede from a primary imprint object after that. What is necessary is just to have shape retaining property at least as the quality of the material of a primary imprint object, and a property, if it says from this point. Since a primary imprint object does not exist at the time of manufacture of a thin film device, it does not need to take into consideration the restrictions on processes, such as thermal resistance and metal contamination.

[0017] Invention of a claim 2 is characterized by the 5th process of the above including the process which light is irradiated [process] at the 1st detached core of the above, and produces ablation in the inside of the layer of the 1st detached core of the above, and/or an interface in a claim 1.

[0018] Light is irradiated at the 1st detached core, it produces and cheats out of an ablation phenomenon in the 1st detached core by this, and the adhesion between the 1st detached core and substrate is reduced. Thereby, the substrate can be made to secede from a transferred layer by applying the force to a substrate.

[0019] In a claim 2, the aforementioned substrate of invention of a claim 3 is a substrate of a translucency, and it is characterized by performing optical irradiation to the 1st detached core of the above through the substrate of the aforementioned translucency.

[0020] Without irradiating direct light at a thin film device, if it carries out like this, ablation can be produced in the 1st detached core and deteriorating reduces the property of a thin film device.

[0021] In a claim 1 or either of 3, the 2nd detached core of the above of invention of a claim 4 is thermofusion nature adhesives, and the 5th process of the above is characterized by including the process to which melting of the aforementioned thermofusion nature adhesives is carried out by heating.

[0022] If adhesives are used as the 2nd detached core, it can be made to serve a double purpose as adhesives for junction of the primary imprint object which is a process after that, and, moreover, separation of a primary imprint object can also be made easy by heating after junction of a primary imprint object.

[0023] Moreover, by making thermofusion nature adhesives serve a double purpose as a flattening layer, though some level differences have arisen on the front face of the transferred layer containing a thin film device, flattening of the level difference can be carried out, and junction on a primary imprint object becomes easy.

[0024] Invention of a claim 5 is characterized by the 7th process of the above including the process which light is irradiated [process] at the 2nd detached core of the above, and produces exfoliation in the inside of the layer of the 2nd detached core of the above, and/or an interface in a claim 1 or either of 3.

[0025] Light is irradiated at the 2nd detached core, it produces and cheats out of an exfoliation phenomenon in the 2nd detached core by this, and the adhesion between the 2nd detached core and a primary imprint object is reduced. Thereby, the primary imprint object can be made to secede from a transferred layer by applying the force to a primary imprint object.

[0026] In a claim 5, the aforementioned primary imprint object of invention of a claim 6 is a translucency, and it is characterized by performing optical irradiation to the 2nd detached core of the above through the aforementioned primary imprint object of a translucency.

[0027] Without irradiating direct light at a thin film device, if it carries out like this, exfoliation can be produced in the 2nd detached core and deteriorating reduces the property of a thin film device.

[0028] Invention of a claim 7 is characterized by the 2nd process of the above including the electrode formation process which flows in this thin film device after formation of the aforementioned thin film device in a claim 1 or either of 6.

[0029] In this case, after carrying out a laminating to the order of a secondary imprint object, a thin film device, and an electrode and imprinting a transferred layer on a secondary imprint object, the wiring to an electrode or contact becomes easy.

[0030] It is desirable to have further the process which removes the 2nd detached core adhering to the transferred layer here.

[0031] The 2nd unnecessary detached core is removed completely.

[0032] Here, like a primary imprint object, if reference is made about the good better quality of the material as a secondary imprint object, a property, etc., since it does not exist at the time of manufacture of a thin film device, the restrictions on processes, such as thermal resistance and metal contamination, can be chosen, without taking into consideration.

[0033] As shown in a claim 8, also let this account imprint object of secondary be a transparent substrate.

[0034] As this transparent substrate, a substrate for example, with a cheap soda-glass substrate etc., the transparent plastic film which has flexibility can be mentioned. It can use as a transparent substrate, then a substrate for the liquid crystal panels with which the thin film device was formed, for example.

[0035] Moreover, as shown in a claim 9, when the maximum temperature in the case of formation of a transferred layer is set to T_{max} , as for a secondary imprint object, it is desirable that a glass transition point (T_g) or softening temperature consists of material below Above T_{max} .

[0036] The maximum temperature at the time of device manufacture cannot be borne, but it is because the cheap glass substrate which has not been used can be used freely conventionally. Thermal resistance [similarly as opposed to the temperature at the time of the process of a thin film device in a primary imprint object] is not needed.

[0037] As shown in a claim 10, a glass transition point (T_g) or softening temperature may be below the maximum temperature of the formation process of a thin film device, because a secondary imprint object is because an imprint object is not exposed to the maximum temperature at the time of formation of a thin film device.

[0038] This secondary imprint object can consist of synthetic resin or glass material, as shown in a claim 11.

[0039] For example, if the synthetic-resin board which has pliability (flexibility), such as plastic film, is used as a secondary imprint object and a thin film device is imprinted to it, in a rigid high glass substrate, an outstanding property which is not acquired is realizable. If this invention is applied to a liquid crystal display, a pliant and light and display unit strong also against fall will be realized.

[0040] Moreover, for example, a substrate with a cheap soda-glass substrate etc. can also be used as a secondary imprint object. A soda-glass substrate is a low price and is an advantageous substrate economically. The soda-glass substrate had the problem that an alkali component was eluted with heat treatment at the time of TFT manufacture, and application to an active-matrix type liquid crystal display was difficult conventionally. However, in order to imprint the already completed thin film device according to this invention, the problem accompanying above-mentioned heat treatment is solved. Therefore, in the field of an active-matrix type liquid crystal display, it becomes usable [a substrate with the conventional problems, such as a soda-glass substrate].

[0041] Next, if reference is made about the quality of the material of the substrate in which a transferred layer is formed, a property, etc., as shown in a claim 12, it is desirable [this substrate] to have thermal resistance.

[0042] It is because desired high temperature processing becomes possible at the time of manufacture of a thin film device and a thin film device with it can be manufactured. [it is reliable and highly efficient]

[0043] Moreover, as for the aforementioned substrate, it is desirable to penetrate 310nm light 10% or more. At this time, the light containing the wavelength of 310nm is irradiated at the optical irradiation process to the 1st detached core.

[0044] The light energy made sufficient for producing exfoliation in the 1st detached core is efficiently performed through a substrate.

[0045] As shown in a claim 13, when the maximum temperature in the case of formation of a transferred layer is set to Tmax, as for the aforementioned substrate, it is desirable that the point [distortion] consists of material beyond Above Tmax.

[0046] It is because desired high temperature processing becomes possible at the time of manufacture of a thin film device and a thin film device with it can be manufactured. [it is reliable and highly efficient]

[0047] Next, when the 1st which produces exfoliation by optical irradiation and/or the desirable quality of the material of the 2nd detached core, a property, etc. are explained, as for this the 1st and/or 2nd detached core, it is desirable to consist of amorphous silicon.

[0048] An amorphous silicon absorbs light, and the manufacture is also easy, the amorphous silicon, and its practicality is high.

[0049] Furthermore, as for the aforementioned amorphous silicon, it is desirable to contain hydrogen (H) more than 2 atom %.

[0050] When the amorphous silicon containing hydrogen is used, hydrogen is emitted with irradiation of light and there is an operation which produces internal pressure in a detached core and stimulates the exfoliation in a detached core by this.

[0051] Or the aforementioned amorphous silicon can contain hydrogen (H) more than 10 atom %.

[0052] When the content of hydrogen increases, the operation to which the exfoliation in a detached core is urged becomes more remarkable.

[0053] A silicon nitride can be mentioned as other quality of the materials of the 1st which produces exfoliation by optical irradiation, and/or 2nd detached core.

[0054] A hydrogen content alloy can be mentioned as the quality of the material of further others of the 1st which produces exfoliation by optical irradiation, and/or 2nd detached core.

[0055] If a hydrogen content alloy is used as this detached core, hydrogen will be emitted with irradiation of light and the exfoliation in a detached core will be promoted by this.

[0056] A nitrogen content metal alloy can be mentioned as the quality of the material of further others of the 1st which produces exfoliation by optical irradiation, and/or 2nd detached core.

[0057] If a nitrogen content alloy is used as this detached core, nitrogen will be emitted with irradiation of light and the exfoliation in a detached core will be promoted by this.

[0058] Also let this detached core be a multilayer.

[0059] It shows clearly not to be limited to a monolayer.

[0060] This multilayer can consist of an amorphous silicon film and a metal membrane formed on it.

[0061] As the quality of the material of further others of the 1st which produces exfoliation by optical irradiation, and/or 2nd detached core, even if there are few ceramics, metals, and organic polymeric materials, it can constitute from a kind.

[0062] A thing actually usable as the 1st which produces exfoliation by optical irradiation, and/or 2nd detached core is illustrated collectively. As a metal, a hydrogen content alloy and a nitrogen content alloy are also usable, for example. In this case, the exfoliation in a detached core is promoted by discharge of the hydrogen gas and the nitrogen gas accompanying irradiation of light like the case of an amorphous silicon.

[0063] Next, when the light used at an optical irradiation process is explained, it is desirable to use a laser beam.

[0064] a laser beam -- a coherent light -- it is -- the [the 1st and/or] -- it is suitable for producing exfoliation in 2 detached cores

[0065] This laser beam can set the wavelength to 100nm - 350nm.

[0066] By using the laser beam of a light energy by short wavelength, exfoliation in the 1st and/or 2nd detached core can be performed effectively.

[0067] As laser which fulfills above-mentioned conditions, there is an excimer laser, for example. An excimer laser is gas laser in which the laser beam output of the high energy of a short wavelength ultraviolet region is possible, and can output the laser beam of four kinds of typical wavelength by using what combined rare gas (Ar, Kr, Xe) and halogen gas (F2, HCl) as a laser medium (XeF=351nm,

XeCl=308nm, KrF=248nm, ArF=193nm).

[0068] By irradiation of excimer laser light, it can produce and cheat out of the operation of direct cutting of molecular binding, evaporation of gas, etc. without a thermal effect in the 1st and/or 2nd detached core.

[0069] As wavelength of a laser beam, 350nm - 1200nm is also employable.

[0070] When making phase changes, such as a gas evolution, evaporation, and sublimation, start and giving a separation property, the laser beam whose wavelength is 350nm - about 1200nm is [in / the 1st and/or 2nd detached core] also usable.

[0071] Next, if a thin film device is explained, as shown in a claim 14, let the aforementioned thin film device be TFT (TFT).

[0072] Highly efficient TFT can be freely imprinted on a desired secondary imprint object (formation). Therefore, it also becomes possible to carry various electronic circuitries on the secondary imprint object.

[0073] In a claim 1 or either of 14, invention according to claim 15 carries out multiple-times execution of the imprint method according to claim 1, and is characterized by imprinting two or more transferred layers on the aforementioned larger secondary imprint object than the aforementioned substrate.

[0074] The large-scale circuit board which carried the reliable thin film device can be created by repeating and using a reliable substrate or carrying out multiple-times execution of the imprint of a thin film pattern using two or more substrates.

[0075] In a claim 1 or either of 14, invention according to claim 16 carries out multiple-times execution of the imprint method according to claim 1, and is characterized by imprinting two or more transferred layers from which the level of the design rule of a thin film device differs on the aforementioned secondary imprint object.

[0076] When it carries two or more circuits (functional block etc. is included) where kinds differ on one substrate, according to the property required of each circuit, the element used for every circuit may differ from the size (what is called design rule, i.e., a design rule) of wiring. Also in this case, if the imprint is performed for every circuit using the imprint method of this invention, two or more circuits where design rule level differs are realizable on one secondary imprint object.

[0077] Invention according to claim 17 is a thin film device which the aforementioned secondary imprint object comes to imprint using the imprint method according to claim 1 to 16.

[0078] It is the thin film device formed on arbitrary substrates (secondary imprint object) using the imprint technology (imprint technology of a diaphragm structure) of the thin film device of this invention.

[0079] Invention according to claim 18 is thin film integrated circuit equipment constituted including the thin film device imprinted by the aforementioned secondary imprint object using the imprint method according to claim 1 to 16.

[0080] For example, it is also possible to carry the single chip microcomputer constituted by using TFT (TFT) on the synthetic-resin substrate.

[0081] Invention according to claim 19 is an active-matrix substrate which the pixel section consists of including the TFT (TFT) arranged in the shape of a matrix, and the pixel electrode connected to the end of the TFT, and is the active-matrix substrate manufactured by imprinting the TFT of the aforementioned pixel section using a method according to claim 1 to 16.

[0082] It is the active-matrix substrate which comes to form the pixel section on a desired substrate (secondary imprint object) using the imprint technology (imprint technology of a diaphragm structure) of the thin film device of this invention. Since the restrictions which come from manufacture conditions are eliminated and a substrate (secondary imprint object) can be chosen freely, it is also possible to realize the new active-matrix substrate which is not in the former.

[0083] The TFT connected to the scanning line by which invention according to claim 20 has been arranged in the shape of a matrix, and a signal line (TFT), The pixel section is constituted including the pixel electrode connected to the end of the TFT. And it is the active-matrix substrate which builds in the driver circuit for supplying a signal to the aforementioned scanning line and the aforementioned signal

line. It is an active-matrix substrate possessing the TFT which constitutes the TFT of the aforementioned pixel section of the 1st design rule level formed using the method according to claim 16, and the aforementioned driver circuit of the 2nd design rule level.

[0084] On an active-matrix substrate, not only the pixel section but a driver circuit is carried, and, moreover, it is the active-matrix substrate from which the design rule level of a driver circuit and the design rule level of the pixel section differ. For example, if the thin film pattern of a driver circuit is formed using the manufacturing installation of Silicon TFT, it is possible to raise a degree of integration.

[0085] Invention according to claim 21 is the liquid crystal display manufactured using the active-matrix substrate according to claim 19 or 20.

[0086] For example, the liquid crystal display with the property at which it turns flexibly using the plastic plate is also realizable.

[0087] Invention according to claim 22 is electronic equipment characterized by having the thin film device which the aforementioned secondary imprint object comes to imprint using the imprint method according to claim 1 to 16. In this case, as shown in a claim 23, it is good also as structure where the aforementioned thin film device is imprinted by the inside of the aforementioned case, and one [at least] outside field, using the case of a device as the aforementioned secondary imprint object.

[0088] The imprint method of the thin film device concerning invention of a claim 24 The 1st process which forms a detached core on a substrate, and the 2nd process which forms the transferred layer containing a thin film device on the aforementioned detached core, It has the 3rd process which removes the aforementioned substrate from the aforementioned transferred layer bordering on the aforementioned detached core, and the 4th process which joins an imprint object to the inferior surface of tongue of the aforementioned transferred layer, and is characterized by imprinting the aforementioned transferred layer containing the aforementioned thin film device on the aforementioned imprint object.

[0089] In invention of a claim 24, the imprint of a transferred layer is enabled using the detached core and the imprint object not using the 1st like invention of a claim 1, the 2nd detached core and primary, and the secondary imprint object. If this method has firmness in the transferred layer itself, it is possible. It is because it is not necessary to support a transferred layer in a primary imprint layer if firmness is in the transferred layer itself, although it is after substrate removal, and the transferred layer needed to be supported with the primary imprint object in invention of a claim 1 before the imprint to a secondary imprint object. At this time, a transferred layer can have not only a thin film device layer but a reinforcement layer.

[0090]

[Embodiments of the Invention] Next, the gestalt of operation of this invention is explained with reference to a drawing.

[0091] (Gestalt of the 1st operation) Drawing 1 - drawing 9 are drawings for explaining the gestalt (the imprint method of a thin film device) of operation of the 1st of this invention.

[0092] As shown in [process 1] drawing 1, the 1st detached core (optical-absorption layer) 120 is formed on a substrate 100.

[0093] Hereafter, a substrate 100 and the 1st detached core 120 are explained.

[0094] ** As for the explanation substrate 100 about a substrate 100, it is desirable that it is what has the translucency which light may penetrate.

[0095] In this case, as for the permeability of light, it is desirable that it is 10% or more, and it is more desirable that it is 50% or more. When this permeability is too low, attenuation (loss) of light becomes large and needs the big quantity of light by exfoliating the 1st detached core 120.

[0096] Moreover, as for a substrate 100, it is desirable to consist of reliable material, and it is desirable to consist of material which was excellent in thermal resistance especially. It is because the width of face of a setup of membrane formation conditions, such as the temperature condition, will spread also in that case on the occasion of formation of the transferred layer 140 grade to a substrate 100 top if the substrate 100 is excellent in thermal resistance, although the reason has what process temperature becomes high in case the transferred layer 140 and interlayer 142 who mention later are formed (for

example, about 350-1000 degrees C) depending on the kind and formation method.

[0097] Therefore, a substrate 100 has a desirable consisting-of [the strain point]-material more than T_{max} thing, when the maximum temperature in the case of formation of the transferred layer 140 is set to T_{max} . Specifically, a thing 350 degrees C or more has a desirable strain point, and the component of a substrate 100 has a more desirable thing 500 degrees C or more. As such a thing, the heat resisting glass of quartz glass, Corning 7059, and NEC glass OA-2 grade is mentioned, for example.

[0098] Moreover, although especially the thickness of a substrate 100 is not limited, usually, it is desirable that it is about 0.1-5.0mm, and it is more desirable that it is about 0.5-1.5mm. If the thickness of a substrate 100 is too thin, a strong fall will be caused, and if too thick, the permeability of a substrate 100 will become easy to produce attenuation of light in a low case. In addition, when the permeability of the light of a substrate 100 is high, the thickness may exceed the aforementioned upper limit. In addition, as for the thickness of a substrate 100, it is desirable that it is uniform so that light can be irradiated uniformly.

[0099] ** The 1st detached core 120 of explanation of the 1st detached core 120 It is what has a property which absorbs the light irradiated and produces ablation (henceforth "ablation in a layer", and "interfacial peeling") in the inside of the layer, and/or an interface. preferably What it arises that the bonding strength between the atoms of the matter which constitutes the 1st detached core 120, or between molecules disappears or decreases, i.e., ablation, and results in the ablation in a layer and/or interfacial peeling by irradiation of light is good.

[0100] Furthermore, a gas may be emitted by irradiation of light from the 1st detached core 120, and the separation effect may be discovered. That is, the 1st detached core 120 absorbs light, it becomes a gas to the case where the component contained in the 1st detached core 120 serves as a gas, and it is emitted for a moment, the steam is emitted, and it may contribute to separation. As composition of such 1st detached core 120, what is indicated by the following A-E is mentioned, for example.

[0101] A. Amorphous silicon (a-Si)

Hydrogen (H) may contain in this amorphous silicon. In this case, as for the content of H, it is desirable that it is a grade more than 2 atom %, and it is more desirable that it is a 2 - 20 atom % grade. Thus, if specified quantity content of the hydrogen (H) is carried out, hydrogen will be emitted by irradiation of light, internal pressure will occur in the 1st detached core 120, and it will become the force in which it exfoliates an up-and-down thin film. The content of the hydrogen in an amorphous silicon (H) can be adjusted by setting up suitably conditions, such as membrane formation conditions, for example, the gas composition in CVD, gas pressure, gas atmosphere, a quantity of gas flow, temperature, substrate temperature, and injection power.

[0102] B. As various oxide ceramics, such as silicon oxide or a silicic-acid compound, titanium oxide or a titanic-acid compound, a zirconium oxide or a zirconic acid compound, a lanthanum trioxide, or a lanthanum oxidization compound, ***** (ferroelectric), or semiconductor silicon oxide, SiO , SiO_2 , and Si_3O_2 are mentioned, and K_2SiO_3 , Li_2SiO_3 , CaSiO_3 and ZrSiO_4 , and Na_2SiO_3 are mentioned as a silicic-acid compound, for example.

[0103] TiO , Ti_2O_3 , and TiO_2 mention as titanium oxide -- having -- as a titanic-acid compound -- BaTiO_4 , BaTiO_3 , $\text{Ba}_2\text{Ti}_9\text{O}_{20}$, $\text{BaTi}_5\text{O}_{11}$, and CaTiO_3 , SrTiO_3 , PbTiO_3 , MgTiO_3 , ZrTiO_2 , SnTiO_4 and aluminum -- TiO_5 and FeTiO_3 are mentioned

[0104] As a zirconium oxide, ZrO_2 is mentioned and BaZrO_3 , ZrSiO_4 , PbZrO_3 , MgZrO_3 , and K_2ZrO_3 are mentioned as a zirconic acid compound, for example.

[0105] C. Ceramics or dielectrics (ferroelectric), such as PZT, PLZT, PLLZT, and PBZT

D. As nitride ceramic E. organic polymeric-materials organic polymeric materials, such as a silicon nitride, nitriding aluminum, and a titanium nitride - CH- , -CO- (Ketone), -CONH- (Amide), -NH- (Imide), - What thing may be used, as long as it has many these combination especially, what has combination (these combination is cut by irradiation of light) of COO- (ester), -N=N- (azo), -CH=N- (CIF), etc., and. Moreover, organic polymeric materials may have an aromatic hydrocarbon (1, two or more benzene rings, or condensed ring of those) in a constructive mood.

[0106] As an example of such organic polymeric materials, polyethylene, a polyolefine like

polypropylene, a polyimide, a polyamide, polyester, a polymethylmethacrylate (PMMA), polyphenylene sulfide (PPS), polyether sulphone (PES), an epoxy resin, etc. are raised.

[0107] F. As a metal metal, the alloy containing at least one of aluminum, Li, Ti, Mn, In, Sn, Y, La, Ce, Nd, Pr, Gd, Sm, or sorts of these is mentioned, for example.

[0108] Moreover, although the thickness of the 1st detached core 120 changes with terms and conditions, such as composition of the exfoliation purpose or the 1st detached core 120, lamination, and the formation method, usually, it is desirable that it is 1nm - about 20 micrometers, it is more desirable that it is 10nm - about 2 micrometers, and it is still more desirable [thickness] that it is 40nm - about 1 micrometer. While enlarging power (quantity of light) of light in order to secure the good detachability of the 1st detached core 120, if the homogeneity of membrane formation is spoiled, nonuniformity may arise in exfoliation, when the thickness of the 1st detached core 120 is too small, and thickness is too thick, in case the 1st detached core 120 is removed behind, the work takes time. In addition, as for the thickness of the 1st detached core 120, it is desirable that it is uniform as much as possible.

[0109] Especially the formation method of the 1st detached core 120 is not limited, but is suitably chosen according to terms and conditions, such as film composition and thickness. For example, it CVD (s) (MOCVD and low voltage -- CVD and efficient consumer response-CVD are included). Vacuum evaporation, molecular-beam vacuum evaporation (MB), sputtering, ion plating, The various gaseous-phase forming-membranes methods, such as PVD, electroplating, immersing plating (dipping), Various plating, such as electroless deposition, the Langmuir pro jet (LB) method, The applying methods, such as a spin coat, a spray coat, and a roll coat, various print processes, a replica method, the ink-jet method, a powder jet process, etc. are mentioned, and it can also form or more [of these] combining two.

[0110] For example, when composition of the 1st detached core 120 is an amorphous silicon (a-Si), it is desirable to form membranes by CVD especially low voltage CVD, or plasma CVD.

[0111] Moreover, when the 1st detached core 120 is constituted from ceramics by the sol-gel method, or when it constitutes from organic polymeric materials, it is desirable the applying method and to form membranes with a spin coat especially.

[0112] As shown in [a process 2], next drawing 2 , the transferred layer (thin film device layer) 140 is formed on the 1st detached core 120.

[0113] The expanded sectional view of K portion (portion shown by surrounding with 1 dotted-line chain line in drawing 2) of this thin film device layer 140 is shown in the right-hand side of drawing 2 . As for the thin film device layer 140, it is constituted including TFT (TFT) formed on SiO₂ film (interlayer) 142, and this TFT possesses the source and the drain layer 146 which introduced n type impurity into the polysilicon contest layer, and were formed, the channel layer 144, the gate insulator layer 148, the gate electrode 150, the layer insulation film 154, and the electrode 152 that consists of aluminum so that it may be illustrated.

[0114] Although SiO₂ film is used as an interlayer prepared in contact with the 1st detached core 120 with the form of this operation, the insulator layer of others, such as Si₃N₄, can also be used. Although the thickness of SiO₂ film (interlayer) is suitably determined according to the formation purpose or the grade of a function which can be demonstrated, usually, it is desirable that it is 10nm - about 5 micrometers, and it is more desirable that it is 40nm - about 1 micrometer. What demonstrates at least one of the functions as the protective layer which an interlayer is formed for the various purpose, for example, protects the transferred layer 140 physically or chemically, an insulating layer, a conductive layer, the shading layer of a laser beam, the barrier layer for migration prevention, and a reflecting layer is mentioned.

[0115] In addition, interlayers, such as SiO₂ film, may not be formed depending on the case, but the direct transferred layer (thin film device layer) 140 may be formed on the 1st detached core 120.

[0116] The transferred layer 140 (thin film device layer) is a layer containing thin film devices, such as TFT as shown in the right-hand side of drawing 2 .

[0117] As a thin film device, besides TFT, for example, thin film diode, The optoelectric transducer (the photosensor, solar battery) and silicon resistance element which consist of PIN junction of silicon, Other thin-film-semiconductor devices, an electrode (example : a transparent electrode like ITO and a mesa

film), Actuators, such as a switching element, memory, and a piezoelectric device, a micro mirror (piezo thin film ceramics), There are a micro MAG device which combined a magnetic-recording thin film head, a coil, an inductor, the charge of a thin film quantity magnetic-permeable material, and them, a filter, a reflective film, a dichroic mirror, etc. It is applicable to the various thin film devices which are not contrary to the meaning of not only the above-mentioned instantiation but this invention.

[0118] Such a thin film device is a relation with the formation method, and is formed through usually comparatively high process temperature. Therefore, as mentioned above in this case, as a substrate 100, what has high reliability that can bear the process temperature is needed.

[0119] As shown in [a process 3], next drawing 3, the thermofusion nature glue line 160 is formed as the 2nd detached core on the thin film device layer 140. In addition, the 2nd detached core can also consist of ablation layers like the 1st detached core.

[0120] As this thermofusion nature glue line 160, there can be fear of the impurity contamination (sodium, potassium, etc.) to a thin film device, for example, can mention electron waxes, such as a proof wax (tradename). [little]

[0121] [Process 4] Further, as shown in drawing 3, the primary imprint object 180 is pasted up on the thermofusion nature glue line 160 which is the 2nd detached core. Since it pastes up after manufacture of the thin film device layer 140, there are no restrictions to the process temperature at the time of manufacture of the thin film device layer 140 etc., and, as for this primary imprint object 180, there should just be even shape retaining property at the time of ordinary temperature. With the form of this operation, a glass substrate, synthetic resin, etc. are comparatively cheap, and material with shape retaining property is used. In addition, the material same as this primary imprint object 180 as the secondary imprint object 200 which mentions a detail later can be used.

[0122] As shown in [a process 5], next drawing 4, light is irradiated from the rear-face side of a substrate 100.

[0123] After this light penetrates a substrate 100, it is irradiated by the 1st detached core 120. Thereby, the exfoliation in a layer and/or interfacial peeling arise in the 1st detached core 120, and bonding strength decreases or disappears.

[0124] It is presumed that it is what is depended on phase changes, such as that ablation produces the principle which the exfoliation in a layer and/or interfacial peeling of the 1st detached core 120 produce in the component of the 1st detached core 120 and discharge of the gas contained in the 1st detached core 120, melting further produced immediately after irradiation, and evapotranspiration.

[0125] The charge of a bridging (component of the 1st detached core 120) which absorbed irradiation light is excited photochemistry-wise or thermally, ablation means combination of the atom of the front face and interior or a molecule being cut, and emitting here, and it mainly appears as a phenomenon in which all or a part of component of the 1st detached core 120 produces phase changes, such as melting and evapotranspiration (evaporation). Moreover, by the aforementioned phase change, it may be in a minute firing state and bonding strength may decline.

[0126] Conditions, such as composition of the 1st detached core 120, and a kind of light irradiated as one of the factor of the, wavelength, intensity, the attainment depth, are mentioned by in addition to this being influenced by various factors they are [whether the 1st detached core 120 produces the exfoliation in a layer, interfacial peeling is produced, or] the both.

[0127] As a light to irradiate, if the 1st detached core 120 is made to start the exfoliation in a layer, and/or interfacial peeling, what thing may be used, for example, an X-ray, ultraviolet rays, the light, infrared radiation (heat ray), a laser beam, a millimeter wave, microwave, an electron ray, radiation (alpha rays, beta rays, gamma ray), etc. will be mentioned. A laser beam is desirable at the point of being easy to produce exfoliation (ablation) of the 1st detached core 120 also in it.

[0128] As laser equipment made to generate this laser beam, although various gas laser, solid state laser (semiconductor laser), etc. are mentioned, an excimer laser, Nd-YAG laser, Ar laser, a CO₂ laser, a CO laser, helium-Ne laser, etc. are used suitably, and especially an excimer laser is desirable also in it.

[0129] Since it outputs a high energy in a short wavelength region, extremely, an excimer laser can make the 1st detached core 2 produce ablation for a short time, and it can exfoliate the 1st detached core

120, without making the imprint object 180 and substrate 100 grade which therefore adjoin produce most temperature rises (i.e., without it producing degradation and damage).

[0130] Moreover, when it makes it faced that the 1st detached core 120 produces ablation and there is a wavelength dependency of light, as for the wavelength of the laser beam irradiated, it is desirable that it is 100nm - about 350nm.

[0131] An example of permeability to the wavelength of light of a substrate 100 is shown in drawing 10. It has the property that permeability increases steeply to the wavelength of 300nm so that it may be illustrated. In such a case, light (for example, Xe-Cl excimer laser light with a wavelength of 308nm) with a wavelength of 300nm or more is irradiated.

[0132] Moreover, when making the 1st detached core 120 start phase changes, such as a gas evolution, evaporation, and sublimation, and giving a separation property to it, as for the wavelength of the laser beam irradiated, it is desirable that it is about 350 to 1200nm.

[0133] Moreover, as for especially the energy density in the case of an excimer laser, it is desirable the energy density of the laser beam irradiated and to consider as about two 10 - 5000 mJ/cm, and it is more desirable to consider as about two 100 - 500 mJ/cm. Moreover, as for irradiation time, it is desirable to be referred to as about 1 - 1000ns, and it is more desirable to be referred to as about 10 - 100ns. When sufficient ablation etc. does not arise, and an energy density is high, when an energy density is low or irradiation time is short, or irradiation time is long, there is a possibility of having a bad influence on the transferred layer 140 by the irradiation light which penetrated the 1st detached core 120.

[0134] In addition, as a cure in case the irradiation light which penetrated the 1st detached core 120 reaches even the transferred layer 140 and does a bad influence, there is the method of forming metal membranes, such as a tantalum (Ta), on the 1st detached core (laser absorption layer) 120, for example. Thereby, it is completely reflected by the interface of a metal membrane 124, and the laser beam which penetrated the 1st detached core 120 does not have a bad influence on the thin film device above it. Or the amorphous silicon layer which is a silicon system laser absorption layer can also be formed through the silicon system intervention layer 2, for example, SiO₂, on the 1st detached core 120. If it carries out like this, the light which penetrated the 1st detached core 120 will be absorbed in the amorphous silicon layer on it. The transmitted light of *Perilla frutescens* (L.) Britton var. *crispa* (Thunb.) Decne. does not merely have a light energy to the extent that ablation is again produced in the upper amorphous silicon layer. Moreover, since a thin film device layer can be formed on an amorphous silicon layer unlike a metal, the thin film device layer which was excellent in quality with the already established thin film coating technology can be formed.

[0135] As for the irradiation light represented by the laser beam, it is desirable to irradiate so that the intensity may become uniform. The direction of radiation of irradiation light may be a direction which carried out the predetermined angle inclination not only to a perpendicular direction but to the 1st detached core 120 to the 1st detached core 120.

[0136] Moreover, when the area of the 1st detached core 120 is larger than the irradiation area which is 1 time of irradiation light, to all the fields of the 1st detached core 120, it can divide into multiple times and irradiation light can also be irradiated. Moreover, you may irradiate the same part twice or more. Moreover, you may irradiate the irradiation light (laser beam) of a different kind and different wavelength (wavelength region) twice or more to the same field or a different field.

[0137] Next, the force is applied to a substrate 100 and this substrate 100 is made to secede from the 1st detached core 120, as shown in drawing 5. Although not illustrated in drawing 5, the 1st detached core 120 may adhere on a substrate 100 after this secession.

[0138] As shown in [a process 6], next drawing 6, the 1st extant detached core 120 is removed by the method which combined methods, such as washing, etching, ashing, and polish, or these. It means that the transferred layer (thin film device layer) 140 had been imprinted by the primary imprint object 180 by this.

[0139] In addition, when a part of 1st detached core 120 has adhered also to the substrate 100 from which it seceded, it removes similarly. In addition, when the substrate 100 consists of an expensive material like quartz glass, and a rare material, reuse (recycling) is preferably presented with a substrate

100. That is, this invention can be applied to the substrate 100 to reuse, and usefulness is high.

[0140] As shown in [a process 7], next drawing 7, the secondary imprint layer 200 is pasted up on the undersurface (exposed surface) of the thin film device layer 140 through a glue line 190.

[0141] As a suitable example of the adhesives which constitute a glue line 190, various hardened type adhesives, such as optical hardening type adhesives, such as reaction hardening type adhesives, heat-hardened type adhesives, and ultraviolet-rays hardening type adhesives, and aversion hardening type adhesives, are mentioned. As composition of adhesives, what thing is sufficient as an epoxy system, an acrylate system, a silicone system, etc., for example. Formation of such a glue line 190 is made for example, by the applying method.

[0142] After applying hardened type adhesives to the undersurface of the transferred layer (thin film device layer) 140 and joining the secondary imprint object 200 further when using the aforementioned hardened type adhesives for example, the aforementioned hardened type adhesives are stiffened by the hardening method according to the property of hardened type adhesives, and the transferred layer (thin film device layer) 140 and the secondary imprint object 200 are pasted up, and it fixes.

[0143] When adhesives are optical hardening types, light is preferably irradiated from the outside of the secondary imprint object 200 of light-transmission nature. As long as it uses as adhesives optical hardening type adhesives, such as an ultraviolet-rays hardening type which cannot affect a thin film device layer easily, you may carry out optical irradiation from the primary imprint object 180 side of light-transmission nature, or primary [of light-transmission nature] and the both sides of the secondary imprint object 180,200.

[0144] In addition, unlike illustration, a glue line 190 may be formed in the secondary imprint object 200 side, and the transferred layer (thin film device layer) 140 may be pasted up on it. In addition, when secondary imprint object 200 the very thing has an adhesion function, for example, you may omit formation of a glue line 190.

[0145] although not limited especially as a secondary imprint object 200 -- a substrate (plate) -- especially a transparent substrate is mentioned In addition, even if such a substrate is monotonous, it may be a curve board. Moreover, compared with the aforementioned substrate 100, properties, such as thermal resistance and corrosion resistance, may be inferior in the secondary imprint object 200. In order that the reason may form the transferred layer (thin film device layer) 140 in a substrate 100 side in this invention and may imprint the transferred layer (thin film device layer) 140 on the secondary imprint object 200 after that, the property required of the secondary imprint object 200, especially thermal resistance are because it is not dependent on the temperature conditions in the case of formation of the transferred layer (thin film device layer) 140 etc. This point is the same also about the primary imprint object 190.

[0146] Therefore, when the maximum temperature in the case of formation of the transferred layer 140 is set to T_{max} , a glass transition point (T_g) or softening temperature can use the following [T_{max}] as a component of primary and the secondary imprint object 190,200. For example, a glass transition point (T_g) or softening temperature can constitute more preferably primary and 800 degrees C or less of 500 degrees C or less of secondary imprint objects 190,200 from material 320 degrees C or less still more preferably.

[0147] Moreover, although what has a certain amount of rigidity (intensity) as a mechanical property of primary and the secondary imprint object 190,200 is desirable, you may have flexibility and elasticity.

[0148] As a component of such primary and the secondary imprint object 190,200, various synthetic resin or various glass material are mentioned, and various synthetic resin and the usual cheap glass material (low melting point) are desirable especially.

[0149] As synthetic resin, any of thermoplastics and thermosetting resin are sufficient. For example, polyethylene, a polo propylene, an ethylene-pre pyrene copolymer, Polyolefines, such as an ethylene vinylacetate copolymer (EVA), an annular polyolefine, A denaturation polyolefine, a polyvinyl chloride, a polyvinylidene chloride, polystyrene, A polyamide, a polyimide, a polyamidoimide, a polycarbonate, Polly (4-methyl BENTEN -1), An ionomer, an acrylic resin, a polymethylmethacrylate, an acrylic-styrene copolymer (AS resin), A Butadiene Styrene, a poliomyelitis copolymer (EVOH), a polyethylene

terephthalate (PET), Polyester, such as polyp CHIREN terephthalate (PBT) and pulley cyclohexane terephthalate (PCT), A polyether, a polyether ketone (PEK), a polyether ether ketone (PEEK), Polyether imide, a polyacetal (POM), a polyphenylene oxide, A denaturation polyphenylene oxide, a polyarylate, an aromatic polyester (liquid crystal polymer), A polytetrafluoroethylene, a polyvinylidene fluoride, other fluorine system resins, A styrene system, a polyolefine system, a polyvinyl chloride system, a polyurethane system, Various thermoplastic elastomer, such as a fluororubber system and a chlorinated-polyethylene system, An EBOKISHI resin, phenol resin, a urea resin, melamine resin, a unsaturated polyester, The copolymer which is mainly concerned with these, a blend object, a polymer alloy, etc. are mentioned, and silicone resin, polyurethane, etc. can be used combining 1 of sorts of these, and two sorts or more (as a layered product for example, more than two-layer).

[0150] As glass material, silicic-acid glass (quartz glass), silicic-acid alkali glass, a soda lime glass, potash-lime glass, lead (alkali) glass, barium glass, borosilicate glass, etc. are mentioned, for example. Among these, compared with silicic-acid glass, the melting point is low, and fabrication and processing are also comparatively easy the melting point, and, moreover, things other than silicic-acid glass have it, and are desirable. [cheap]

[0151] When using what consisted of synthetic resin as a secondary imprint object 200, while being able to fabricate the large-scale secondary imprint object 200 in one, even if it is complicated configurations, such as what has a curve side and irregularity, it can manufacture easily, and the various advantages that material cost and a manufacturing cost are also cheap can be enjoyed. Therefore, use of synthetic resin is advantageous when manufacturing a large-sized and cheap device (for example, liquid crystal display).

[0152] In addition, the secondary imprint object 200 may constitute a part of device like what constitutes the device which became independent in itself like a liquid crystal cell, a light filter and an electrode layer, a dielectric layer, an insulating layer, and a semiconductor device.

[0153] Furthermore, primary and the secondary imprint objects 190,200 may be matter, such as a metal, ceramics, a stone, and wood paper, and may be on the front face of the structures, such as a wall, a pillar, a ceiling, and a windowpane, further on the arbitrary fields which constitute a certain article (superiors of the front-face top of the field top of a clock, and an air-conditioner, and a printed circuit board).

[0154] As shown in [a process 8], next drawing 8, the thermofusion of the thermofusion nature glue line 160 which is the 2nd detached core is heated and carried out. Consequently, since the adhesive strength of the thermofusion nature glue line 160 becomes weaker, it can be made to secede from the primary imprint object 180 by the thin film device layer 140. In addition, this primary imprint object 180 can be repeated and reused by removing the thermofusion nature adhesives adhering to the primary imprint object 180.

[0155] By removing the thermofusion nature glue line 160 which adhered to the front face of the thin film device layer 140 at the [process 9] last, as shown in drawing 9, the thin film device layer 140 imprinted by the secondary imprint object 200 can be obtained. Here, the laminating relation of the thin film device layer 140 to this secondary imprint object 200 becomes the same as the laminating relation of the thin film device layer 140 to the original substrate 100, as shown in drawing 2.

[0156] The imprint to the secondary imprint object 200 of the transferred layer (thin film device layer) 140 is completed through each above process. Then, conductive layers, such as removal of SiO₂ film which adjoins the transferred layer (thin film device layer) 140, and wiring of a up to [the transferred layer 140], formation of a desired protective coat, etc. can also be performed.

[0157] In this invention, transferred layer (thin film device layer) 140 the very thing which is an exfoliated object is not exfoliated directly. In order to dissociate in the 1st detached core 120 and the 2nd detached core 160 and to imprint on the secondary imprint object 200, Irrespective of the property of a dissociated object (transferred layer 140), conditions, etc., it can imprint easily and uniformly certain moreover, there is also no damage to the dissociated object (transferred layer 140) in accordance with separation operation, and the high reliability of the transferred layer 140 can be maintained.

[0158] (Form of the 2nd operation) TFT of CMOS structure is formed on a substrate and the example of the concrete manufacture process in the case of imprinting this on an imprint object is explained using

drawing 11 - drawing 21 .

[0159] (Process 1) As shown in drawing 11 , on a substrate (for example, quartz substrate) 100, laminating formation of the 1st detached core (for example, amorphous silicon layer formed by the LPCVD method) 120, an interlayer (for example, SiO₂ film) 142, and the amorphous silicon layer (for example, formed by the LPCVD method) 143 is carried out one by one, then a laser beam is irradiated from the upper part all over the amorphous silicon layer 143, and annealing is given. Thereby, the amorphous silicon layer 143 is recrystallized and turns into a polysilicon contest layer.

[0160] (Process 2) Then, as shown in drawing 12 , patterning of the polysilicon contest layer obtained by laser annealing is carried out, and Islands 144a and 144b are formed.

[0161] (Process 3) As shown in drawing 13 , the wrap gate insulator layers 148a and 148b are formed for Islands 144a and 144b by CVD.

[0162] (Process 4) As shown in drawing 14 , the gate electrodes 150a and 150b which consist of contest polysilicon or metal are formed.

[0163] (Process 5) As shown in drawing 15 , the mask layer 170 which consists of a polyimide etc. is formed, using gate electrode 150b and the mask layer 170 as a mask, it is a self aryne, for example, the ion implantation of boron (B) is performed. Of this, the p⁺ layers 172a and 172b are formed.

[0164] (Process 6) As shown in drawing 16 , the mask layer 174 which consists of a polyimide etc. is formed, using gate electrode 150a and the mask layer 174 as a mask, it is a self aryne, for example, the ion implantation of Lynn (P) is performed. Of this, the n⁺ layers 146a and 146b are formed.

[0165] (Process 7) As shown in drawing 17 , the layer insulation film 154 is formed and Electrodes 152a-152d are alternatively formed after contact hole formation.

[0166] Thus, TFT of the formed CMOS structure corresponds to the transferred layer (thin film device layer) 140 in drawing 2 - drawing 9 . In addition, you may form a protective coat on the layer insulation film 154.

[0167] (Process 8) As shown in drawing 18 , the thermofusion nature glue line 160 as the 2nd detached core is formed on TFT of CMOS composition. At this time, flattening of the level difference produced on the surface of TFT is carried out by the thermofusion nature adhesives 160. In addition, the 2nd detached core can also consist of ablation layers like the 1st detached core.

[0168] It is desirable to form protective layers, such as an insulating layer, first on TFT which is a thin film device here, and to prepare the 2nd detached core on the protective layer. When the 2nd detached core is especially used as an ablation layer, a thin film device layer can be protected by the protective layer at the time of ablation.

[0169] Moreover, when forming especially the 2nd detached core in an ablation layer, the 2nd detached core itself can also be formed in a multilayer like the 1st detached core. Furthermore, it is still better to prepare shading layers, such as a metal layer, between this 2nd detached core and a thin film device layer. It is because it can prevent that light carries out incidence to a thin film device layer at the time of ablation.

[0170] After this 2nd detached core formation, TFT is stuck on the primary imprint object (for example, soda-glass substrate) 180 through the thermofusion nature glue line 160 which is the 2nd detached core.

[0171] (Process 9) As shown in drawing 19 , Xe-Cl excimer laser light is irradiated from the rear face of a substrate 100, for example. This produces and cheats out of exfoliation in the inside of the layer of the 1st detached core 120, and/or an interface.

[0172] (Process 10) A substrate 100 is torn off as shown in drawing 20 .

[0173] (Process 11) Etching removes the 1st detached core 120 further. It means that TFT of CMOS composition had been imprinted by the primary imprint object 180 by this as shown in drawing 21 .

[0174] (Process 12) Next, as shown in drawing 22 , the epoxy resin layer 190 is formed in the undersurface of TFT of CMOS composition as a glue line with a hardening point lower than the thermofusion nature resin layer 160. Next, TFT is stuck on the secondary imprint object (for example, soda-glass substrate) 200 through the epoxy resin layer 190. Then, heat is applied, the epoxy resin layer 190 is stiffened, and the secondary imprint object 200 and TFT are pasted up (junction).

[0175] (Process 13) Next, as shown in drawing 23 , melting of the thermofusion nature resin layer 160 is

carried out with heat using oven 210, and TFT is torn off from the primary imprint object 180 bordering on this thermofusion nature resin layer 160. Furthermore, a xylene etc. removes the thermofusion nature resin layer 160 which remains on the undersurface of TFT. Thereby, TFT is imprinted by the secondary imprint object 200 as shown in drawing 24. The state of this drawing 24 becomes the same as what transposed the substrate 100 shown in drawing 17, and the 1st detached core 120 to the secondary imprint object 200 and the glue line 190. Therefore, the laminating relation to the substrate 100 used for the manufacturing process of TFT is secured on the secondary imprint object 200. For this reason, Electrodes 152a-152d are exposed, and the contact or wiring to it can be performed easily. In addition, after considering as the state of drawing 24, you may form a protective layer in the surface.

[0176] (Form of the 3rd operation) if the technology explained with the form of the 1st operation of a **** and the form of the 2nd operation is used, the microcomputer constituted using the thin film device as shown in drawing 25 (a), for example can be formed on the substrate which is a request

[0177] In drawing 25 (a), the solar battery 340 possessing the PIN junction of an amorphous silicon for supplying the supply voltage of these circuits to CPU300, RAM320, and the I/O circuit 360 row from which the thin film device was used and which the circuit consisted of is carried on the flexible substrate 182 as a secondary imprint object which consists of plastics etc.

[0178] Since the microcomputer of drawing 25 (a) is formed on the flexible substrate 182 which is a secondary imprint object, as shown in drawing 25 (b), since it is lightweight, it has strongly the feature that it is strong also to fall in bending. Moreover, the plastic plate 182 shown in drawing 25 (a) may make the case of electronic equipment serve a double purpose. If it carries out like this, the electronic equipment by which the thin film device was imprinted by either [at least] the inside of a case or external surface can be manufactured.

[0179] (Form of the 4th operation) the form of this operation explains the example which is a manufacture process in the case of creating the active-matrix type liquid crystal display using the active-matrix substrate as shown in drawing 26 using the imprint technology of an above-mentioned thin film device

[0180] (Composition of a liquid crystal display) As shown in drawing 26, an active-matrix type liquid crystal display possesses the lighting light sources 400, such as a back light, a polarizing plate 420, the active-matrix substrate 440, liquid crystal 460, the opposite substrate 480, and a polarizing plate 500.

[0181] In addition, if it constitutes as a reflected type liquid crystal panel which replaced with the lighting light source 400 and adopted the reflecting plate when using a flexible substrate like plastic film for the active-matrix substrate 440 and the opposite substrate 480 of this invention, there is flexibility and a lightweight active matrix liquid crystal panel strong against a shock and can be realized. In addition, when a pixel electrode is formed with a metal, a reflecting plate and a polarizing plate 420 become unnecessary.

[0182] The active-matrix substrate 440 used with the form of this operation arranges TFT in the pixel section 442, and is a driver built-in active-matrix substrate in which the driver circuit (a scanning-line driver and data-line driver) 444 was carried further.

[0183] The cross section of the important section of this active matrix liquid crystal display is shown in drawing 27, and the circuitry of the important section of a liquid crystal display is shown in drawing 28.

[0184] As shown in drawing 28, the gate is connected to the gate line G1, one side of a source drain is connected to the data line D1, and the pixel section 442 contains TFT (M1) by which another side of a source drain was connected to liquid crystal 460, and liquid crystal 460.

[0185] Moreover, the driver section 444 is constituted including TFT (M2) formed of the same process as TFT (M1) of the pixel section.

[0186] As shown in the left-hand side of drawing 27, TFT (M1) in the pixel section 442 is constituted including the source drain layers 1100a and 1100b, channel 1100e, gate insulator layer 1200a, gate electrode 1300a, an insulator layer 1500, and the source drain electrodes 1400a and 1400b.

[0187] In addition, a reference number 1700 is a pixel electrode and a reference number 1702 shows the field (voltage impression field to liquid crystal) where the pixel electrode 1700 impresses voltage to

liquid crystal 460. The orientation film is omitted among drawing. The pixel electrode 1700 is constituted by metals (in the case of a reflected type liquid crystal panel), such as ITO (in the case of a light-transmission type liquid crystal panel), or aluminum.

[0188] Moreover, as shown in the right-hand side of drawing 27, TFT (M2) which constitutes the driver section 444 is constituted including the source, the drain layers 1100c and 1100d, channel 1100f, gate insulator layer 1200b, gate electrode 1300b, an insulator layer 1500, and the source drain electrodes 1400c and 1400d.

[0189] In addition, in drawing 27, a reference number 480 is for example, an opposite substrate (for example, soda-glass substrate), and a reference number 482 is a common electrode. Moreover, a reference number 1000 is SiO₂ film, a reference number 1600 is a layer insulation film (for example, SiO₂ film), and a reference number 1800 is a glue line. Moreover, a reference number 1900 is a substrate (imprint object) which consists for example, of a soda-glass substrate.

[0190] (Manufacture process of a liquid crystal display) The manufacture process of the liquid crystal display of drawing 27 is hereafter explained with reference to drawing 29 - drawing 34.

[0191] First, it forms through the same manufacture process as drawing 11 - drawing 21 on the substrate (for example, quartz substrate) 3000 which it is reliable in TFT (M1, M2) like drawing 29, and penetrates a laser beam, and a protective coat 1600 is constituted. In addition, in drawing 29, a reference number 3100 is the 1st detached core (laser absorption layer). Moreover, in drawing 29, both TFT (M1, M2) is taken as n type MOSFET. However, it is good also as not the thing limited to this but p type MOSFET, and CMOS structure.

[0192] Next, as shown in drawing 30, the pixel electrode 1700 which consists of metals, such as an ITO film which *****s alternatively and flows through a protective coat 1600 in electrode 1400a, or aluminum, is formed. In using an ITO film, it becomes a penetrated type liquid crystal panel, and in using metals, such as aluminum, it becomes a reflected type liquid crystal panel.

[0193] Next, as shown in drawing 31, the substrate 1900 which is a primary imprint object is joined through the thermofusion nature glue line 1800 which is the 2nd detached core (adhesion). In addition, the 2nd detached core can also consist of ablation layers like the 1st detached core.

[0194] Next, as shown in drawing 31, excimer laser light is irradiated from the rear face of a substrate 3000, and a substrate 3000 is torn off after this.

[0195] Next, the 1st detached core (laser absorption layer) 3100 is removed. Thereby, as shown in drawing 32, the pixel section 442 and the driver section 44 are imprinted by the primary imprint object 1900.

[0196] Next, as shown in drawing 33, the secondary imprint object 2100 is joined to the undersurface of SiO₂ film 1000 through the thermosetting glue line 2000.

[0197] Then, the primary imprint object 1900 is laid on oven, for example, melting of the thermofusion nature adhesives 1800 is carried out, and it is made to secede from the primary imprint object 1900. The thermofusion nature glue line 1900 adhering to the protective coat 1600 and the pixel electrode 1700 is also removed.

[0198] Thereby, as shown in drawing 34, the active-matrix substrate 440 imprinted by the secondary imprint object 2100 is completed. It has exposed from the surface and the electric connection with liquid crystal is possible for the pixel electrode 1700. Then, an orientation film is formed in the front face of the insulator layer (interlayers, such as SiO₂) 1000 of the active-matrix substrate 440, and the front face of the pixel electrode 1700, and orientation processing is performed. The orientation film is omitted in drawing 34.

[0199] And further, as shown in drawing 27, the pixel electrode 1700 and the common electrode which counters are formed in the front face, the opposite substrate 480 by which orientation processing of the front face was carried out, and the acouchi boomer TORIKU substrate 440 are closed with a sealing agent (sealant), liquid crystal is enclosed among both substrates, and a liquid crystal display is completed.

[0200] (Form of the 5th operation) The form of operation of the 5th of this invention is shown in drawing 35.

[0201] With the form of this operation, multiple-times execution of the imprint method of an above-mentioned thin film device is carried out, on a larger substrate (imprint object) than the substrate of an imprinting agency, two or more patterns containing a thin film device are imprinted, and, finally a large-scale active-matrix substrate is formed.

[0202] That is, on the big substrate 7000, the imprint of multiple times is performed and the pixel sections 7100a-7100P are formed. TFT and wiring are formed in the pixel section as surrounded and shown to the drawing 35 bottom by the alternate long and short dash line. In drawing 35, a reference number 7200 is a signal line, a reference number 7210 is the scanning line and a reference number 7230 is [a reference number 7220 is a gate electrode and] a pixel electrode.

[0203] The large-scale active-matrix substrate in which the reliable thin film device was carried can be created by repeating and using a reliable substrate or carrying out multiple-times execution of the imprint of a thin film pattern using two or more 1st substrates.

[0204] (Form of the 6th operation) The form of operation of the 6th of this invention is shown in drawing 36.

[0205] The feature of the form of this operation is imprinting two or more patterns containing the thin film device (thin film device from which it is got blocked and a minimum line width's differs) from which multiple-times execution of the imprint method of an above-mentioned thin film device is carried out, and a design rule's (that is, design rule's when carrying out a pattern design's) differs on a bigger substrate than the substrate top of an imprinting agency.

[0206] In drawing 36, the driver circuit (8000-8032) created in the more detailed manufacture process rather than the pixel section (7100a-7100p) is created around the substrate 6000 by the imprint of multiple times in the active-matrix substrate of driver loading.

[0207] Since the shift register which constitutes a driver circuit carries out operation of logic level to the bottom of a low battery, from Pixel TFT, pressure-proofing may be low, and as it is therefore set to TFT more detailed than Pixel TFT, high integration can be attained.

[0208] According to the form of this operation, two or more circuits where design rule level differs (that is, manufacture processes differ) are realizable on one substrate. In addition, since high pressure-proofing is required for a sampling means (TFT M2 of drawing 25) to sample a data signal by control of a shift register, like Pixel TFT, it is good to form with the same process as Pixel TFT / same design rule.

[0209] (Form of the 7th operation) Drawing 37 and drawing 38 are replaced with the thermofusion nature glue line 160 as the 2nd detached core used with the form of the 1st operation, it is the same as the 1st detached core 120 of the form of the 1st operation, for example, the modification using the amorphous silicon layer 220 is shown. As shown in drawing 37, the primary imprint object 180 is joined through the glue line 230 on this FUMORU face silicon layer 220. Moreover, drawing 37 shows the optical irradiation process for producing ablation in the 1st detached core 120, and after the process of drawing 4, and the optical irradiation process of corresponding drawing 37, this joins the secondary imprint object 200 through a glue line 190, as a substrate 100 and the 1st detached core 120 are removed from the undersurface of the thin film device layer 140 and are shown in drawing 38. As shown in drawing 38 next, optical irradiation is carried out from the primary imprint object 180 side at the amorphous silicon layer 220. Thereby, ablation arises in the amorphous silicon layer 220. Consequently, the primary imprint object 180 and a glue line 230 can be ***** (ed) in the thin film device layer 140.

[0210] Thus, ablation may be produced one by one on the both sides of the 1st and the 2nd detached core, and the secondary imprint object 200 may be made to imprint the thin film device layer 140 in this invention.

[0211]

[Example] Next, the concrete example of this invention is explained.

[0212] (Example 1) The quartz substrate (softening temperature : 1630 degrees C, a strain point : 1070 degrees C, permeability of an excimer laser : almost 100%) with a 50mm[50mm by] x thickness of 1.1mm was prepared, and the amorphous silicon (a-Si) film was formed in one side of this quartz substrate by low voltage CVD (Si₂ H₆ gas, 425 degrees C) as the 1st detached core (laser beam

absorption layer). The thickness of the 1st detached core was 100nm.

[0213] Next, it is SiO₂ as an interlayer on the 1st detached core. The film was formed by efficient consumer response-CVD (SiH₄+O₂ gas, 100 degrees C). An interlayer's thickness was 200nm.

[0214] Next, the amorphous silicon film of 50nm of thickness was formed by low voltage CVD (Si₂ H₆ gas, 425 degrees C) as a transferred layer on the interlayer, a laser beam (wavelength of 308nm) is irradiated, this amorphous silicon film was crystallized, and it considered as the polysilicon contest film. Then, to this polysilicon contest film, predetermined patterning was performed and the field used as the source drain channel of TFT was formed. then, the elevated temperature more than 1000 degreeC -- a polysilicon contest film front face -- oxidizing thermally -- gate insulator layer SiO₂ after forming, form a gate electrode (structure where laminating formation of the refractory metals, such as Mo, was carried out at contest polysilicon), on a gate insulator layer, and it carries out an ion implantation, using a gate electrode as a mask -- self -- being conformable (selfer line) -- the source drain field was formed and TFT was formed Then, the electrode connected to a source drain field and wiring, and the wiring which leads to a gate electrode are formed if needed. Although aluminum is used for these electrodes and wiring, it is not limited to this. Moreover, when worrying about melting of aluminum by the laser radiation of a back process, you may use the metal (what is not fused by the laser radiation of a back process) of a high-melting point rather than aluminum.

[0215] Next, thermofusion nature adhesives (tradename : proof wax) were applied on the aforementioned TFT, and the transparent large-sized glass substrate (a soda glass, softening temperature:740 degree C, strain-point:511 degree C) with a 300mm[200mm by] x thickness of 1.1mm was joined as a primary imprint object.

[0216] Next, the Xe-Cl excimer laser (wavelength : 308nm) was irradiated from the quartz substrate side, and the 1st detached core was made to produce exfoliation (exfoliation in a layer, and interfacial peeling). The energy density of the irradiated Xe-Cl excimer laser was 250 mJ/cm², and irradiation time was 20ns. in addition, a unit field (for example, 8mmx8mm) predetermined when irradiation of an excimer laser has spot beam irradiation and line beam irradiation and it is spot beam irradiation -- spot irradiation -- carrying out -- this spot irradiation -- a unit field -- it irradiates with staggering about [every] 1/10 Moreover, in line beam irradiation, similarly, the predetermined unit field (for example, 378mmx0.1mm and 378mmx0.3mm (field where, as for these, 90% or more of energy is acquired)) is irradiated with staggering about [every] 1/10. Thereby, each point of the 1st detached core receives at least ten irradiation. This laser radiation is carried out to the whole quartz substrate surface, shifting an irradiation field.

[0217] Then, a quartz substrate and glass-substrate primary (imprint object) were torn off in the 1st detached core, and the TFT and the interlayer who were formed on the quartz substrate were primarily imprinted to the glass-substrate side which is a primary imprint object.

[0218] Then, etching, washing, or those combination removed the 1st detached core adhering to the front face of the interlayer by the side of a glass substrate. Moreover, processing with the same said of a quartz substrate was performed, and the reuse was presented.

[0219] Furthermore, after applying ultraviolet-rays hardening type adhesives to the undersurface of the interlayer who exposed (thickness : 100 micrometers) and joining a transparent large-sized glass substrate (a soda glass, softening temperature:740 degree C, strain-point:511 degree C) with a 300mm [200mm by] x thickness of 1.1mm to it as a secondary imprint object further at the paint film, ultraviolet rays were irradiated from the glass-substrate side, adhesives were stiffened, and adhesion fixation of these was carried out.

[0220] Then, the thermofusion of the thermofusion nature adhesives was carried out, and the glass substrate which is a primary imprint object was removed. This imprinted TFT and the interlayer secondarily to the glass-substrate side which is a secondary imprint object. In addition, a primary imprint object is also reusable with washing.

[0221] Here, if the glass substrate used as a primary imprint object is a bigger substrate than a quartz substrate, the primary imprint to a glass substrate from a quartz substrate like this example can be repeatedly carried out to a superficially different field, and much TFT can be formed on a glass substrate

from the number of the TFT which can be formed in a quartz substrate. Furthermore, on a glass substrate, a laminating can be carried out repeatedly and more TFT can be formed similarly. Or the glass substrate used as a secondary imprint object can be used as a large-sized substrate rather than a primary imprint object and a quartz substrate, a secondary imprint can be repeated and carried out, and much TFT can also be formed from the number of the TFT which can be formed in a quartz substrate.

[0222] (Example 2) the 1st detached core -- H (hydrogen) -- 20at(s)% -- TFT was imprinted like the example 1 except having considered as the amorphous silicon film to contain

[0223] In addition, adjustment of the amount of H in an amorphous silicon film was performed by setting up suitably the conditions at the time of membrane formation by low voltage CVD.

[0224] (Example 3) TFT was imprinted like the example 1 except having made the 1st detached core into the ceramic thin film (composition: bTiO_3 , thickness: 200nm) formed with the sol-gel method with the spin coat.

[0225] (Example 4) TFT was imprinted like the example 1 except having made the 1st detached core into the ceramic thin film (composition: BaTiO_3 , thickness: 400nm) formed by sputtering.

[0226] (Example 5) TFT was imprinted like the example 1 except having made the 1st detached core into the ceramic thin film (composition: $\text{Pb}(\text{Zr}, \text{Ti})\text{O}_3$ (PZT) and thickness: 50nm) formed by the laser-ablation method.

[0227] (Example 6) TFT was imprinted like the example 1 except having used the 1st detached core as the polyimide film (thickness: 200nm) formed with the spin coat.

[0228] (Example 7) TFT was imprinted like the example 1 except having used the 1st detached core as the polyphenylene sulfide film (thickness: 200nm) formed with the spin coat.

[0229] (Example 8) TFT was imprinted like the example 1 except having used the 1st detached core as aluminum layer (thickness: 300nm) formed by sputtering.

[0230] (Example 9) As an irradiation light, TFT was imprinted like the example 2 except having used the Kr-F excimer laser (wavelength: 248nm). In addition, the energy density of the irradiated laser was 250 mJ/cm², and irradiation time was 20ns.

[0231] (Example 10) As an irradiation light, TFT was imprinted like the example 2 except having used Nd-YAIG laser (wavelength: 1068nm). In addition, the energy density of the irradiated laser was 400 mJ/cm², and irradiation time was 20ns.

[0232] (Example 11) TFT was imprinted like the example 1 except having considered as the TFT of the polysilicon contest film (80nm of thickness) by elevated-temperature process 1000 degree C as a transferred layer.

[0233] (Example 12) As an imprint object, TFT was imprinted like the example 1 except having used the transparent substrate made from a polycarbonate (glass transition point: 130 degrees C).

[0234] (Example 13) As an imprint object, TFT was imprinted like the example 2 except having used the transparent substrate made of an AS resin (glass transition point: 70-90 degrees C).

[0235] (Example 14) As an imprint object, TFT was imprinted like the example 3 except having used the transparent substrate made from a polymethylmethacrylate (glass transition point: 70-90 degrees C).

[0236] (Example 15) As an imprint object, TFT was imprinted like the example 5 except having used the transparent substrate made from a polyethylene terephthalate (glass transition point: 67 degrees C).

[0237] (Example 16) As an imprint object, TFT was imprinted like the example 6 except having used the transparent substrate made from a high density polyethylene (glass transition point: 77-90 degrees C).

(Example 17) As an imprint object, TFT was imprinted like the example 9 except having used the transparent substrate made from a polyamide (glass transition point: 145 degrees C).

[0238] (Example 18) As an imprint object, TFT was imprinted like the example 10 except having used the transparent substrate made of an epoxy resin (glass transition point: 120 degrees C).

[0239] (Example 19) As an imprint object, TFT was imprinted like the example 11 except having used the transparent substrate made from a polymethylmethacrylate (glass transition point: 70-90 degrees C).

[0240] About examples 1-19, when the state of the imprinted TFT was guessed the ** view under the naked eye and the microscope, respectively, all had neither a defect nor nonuniformity and the imprint was made uniformly.

[0241] It becomes possible to imprint a thin film device (transferred layer) secondarily to various imprint objects, maintaining the built-up sequence which was described above and which was formed in the substrate like, when using the imprint technology of this invention. or [for example, / that a thin film cannot be formed directly] -- or it can be formed by imprint also to what consisted of material unsuitable for forming, material with easy fabrication, a cheap material, etc., the large-sized body which is hard to move

[0242] That in which properties, such as thermal resistance and corrosion resistance, are inferior compared with various synthetic resin or substrate material like the low glass material of the melting point can be used especially for an imprint object. therefore -- for example, it can face manufacturing the liquid crystal display in which TFT (especially the polysilicon contest TFT) was formed on the transparent substrate, and a large-sized and cheap liquid crystal display can be easily manufactured now as an imprint object as a substrate using the quartz-glass substrate which is excellent in thermal resistance by using a transparent substrate of the material which it is cheap and processing tends to carry out like the low glass material of various synthetic resin or the melting point Such an advantage is the same also about manufacture of not only a liquid crystal display but other devices.

[0243] Moreover, although the above advantages are enjoyed, since a transferred layer like a functional thin film can be formed to a heat-resistant high substrate like a reliable substrate, especially a quartz-glass substrate and patterning can be carried out further, a reliable functional thin film can be formed on an imprint object irrespective of the material property of an imprint object.

[0244] Moreover, although such a reliable substrate is expensive, it is also possible to reuse it and, therefore, a manufacturing cost is also reduced.

[0245] Moreover, according to another form of this invention, it is also possible to imprint a firm transferred layer from a substrate to an imprint object side only using much more detached core and one imprint object, without necessarily using the 1st, the 2nd detached core and primary, and a secondary imprint object as mentioned above. In order to give firmness to the transferred layer itself, the insulating layer in a thin film device can be thickened, or a reinforcement layer can be formed.

[0246]

[Translation done.]